

证券简称：信维通信

证券代码：300136



深圳市信维通信股份有限公司

(SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO., LTD.)

(注册地址：广东省深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A,B 栋)

2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿)

保荐人（主承销商）



二〇二六年三月

发行人声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以同一价格认购本次向特定对象发行股票。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P_1 。

最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 290,270,591 股（含本数），最终发行数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权公司董事会根据中国证监会、深交所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入
1	商业卫星通信器件及组件项目	356,316.21	285,000.00
2	射频器件及组件项目	285,270.72	215,000.00
3	芯片导热散热器件及组件项目	116,941.91	100,000.00
合计		758,528.84	600,000.00

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

6、本次发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期届满后，发行对象减持还需根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

9、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法规的要求，公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，并制定了《深圳市信维通信股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司即期回报摊薄的风险进行了认真分析，并拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。

11、本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册。上述批准或注册事宜均为本次向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关的批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、特别风险提示

与本次发行相关的风险因素详见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

（一）行业下游需求波动风险

发行人主营业务与消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等下游应用市场高度关联，而上述下游应用领域的发展与全球宏观经济走势、消费者可支配收入水平及消费意愿密切相关。当全球或主要经济体出现经济下行、通胀高企等情况时，消费者会延迟智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等终端产品的更换周期，导致下游终端厂商缩减生产计划及采购规模，进而传导至包括射频元器件制造在内的上游行业，造成公司产品需求下滑、订单减少。此外，公司新兴业务所处的卫星通信、智能汽车领域虽处于高增长阶段，但仍可能受宏观经济波动影响，出现市场需求不及预期的风险。同时，随着 5G 建设进入中后期，6G 商用尚未进入规模化阶段，行业需求存在阶段性波动风险。

（二）市场竞争风险

射频元器件行业具备创新周期短、产品迭代快的特征，下游需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入，通过持续研发来保证产品在技术上的领先性。但与此同时，公司的主要竞争对手也在资金、人员、技术上具备匹配度，随着公司主要产品的不断迭代和类别的不断延伸，公司将面临更加激烈的市场竞争。

公司在主要产品生产规模和工艺技术方面具有较强的市场竞争能力，显现出良好的发展前景，但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

（三）原材料价格、人工成本上涨风险

公司主要成本为原材料、制造费用和人工。2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司综合毛利率分别为 21.81%、22.07%、20.82%和 21.53%，表现出较强的盈利能力和成本上涨的消化能力。但是，若原材料价格、人工成本持续上涨，公司产品成本上升仍将对公司利润造成不利影响。

（四）外贸环境恶化的风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司境外销售收入占营业收入的比重分别为 78.22%、81.33%、73.22%和 65.42%，比重较高。公司已与主要海外客户建立了良好、稳定的合作关系，但公司产品出口仍然受到电子产品及其零

部件进出口政策变化等多方面外贸环境的制约，若国际市场的政治稳定性、外贸政策出现重大变化，将可能对公司生产经营产生重大影响，直接或间接影响公司的出口业务。

（五）业务快速扩张的管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，公司员工人数相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

（六）汇率波动的风险

公司主要经营地位于中国境内，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司境外销售收入占营业收入的比重分别为 78.22%、81.33%、73.22%和 65.42%，公司向海外客户的销售收入主要以外币结算，因此存在较大的美元应收账款余额。随着公司的海外业务不断拓展，若人民币汇率发生较大幅度的波动，而公司如不能采取有效的应对措施，可能会导致公司开展的海外业务在外汇结算过程中面临汇率风险，进而在一定程度上影响公司盈利水平。

为提高公司应对外汇波动风险的能力，公司开展了外汇套期保值业务，但同时也存在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致造成的汇兑损失与汇率在未来发生波动时与外汇套期保值合约偏差较大时造成汇兑损失等风险。

（七）主要客户集中风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为 52.44%、59.88%、50.83%和 48.60%，客户集中度较高。若公司主要客户的生产经营情况发生不利变化或产品结构调整，导致其对公司产品的需求减少，公司的生产经营将受到不利影响，致使公司面临业绩下滑的风险。

（八）商誉减值的风险

截至 2025 年 9 月 30 日，公司商誉账面原值为 100,244.54 万元，主要系收购

深圳亚力盛连接器有限公司、维仕科技有限公司形成。根据《企业会计准则》，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如发生减值，则应当确认商誉的减值损失，减值部分将冲减公司当期利润。

截至 2025 年 9 月 30 日，深圳亚力盛连接器有限公司、维仕科技有限公司经营情况正常，公司未曾计提商誉减值准备。若前述公司未来经营状况未能达到预期，将存在商誉减值风险，对公司业绩造成不利影响。

（九）募集资金投资项目新增产能消化及预计效益实现风险

公司本次募集资金投资于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”。上述项目的实施有助于公司落实发展战略、扩大经营规模和提升盈利水平。虽然公司对上述项目的市场前景以及可行性进行了充分的论证，但竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、行业技术的变革、宏观经济形势的变化以及营销渠道的开拓等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响，特别是卫星发射能力、网络服务的连续性与稳定性，以及终端成本、资费水平与规模化用户培育周期等商业卫星通信行业发展的关键要素均存在较大的不确定性。

现阶段，公司第二增长曲线业务虽然在前期投入下取得较明显进展，但整体业务规模仍处于发展早期，其市场根基有待进一步夯实。若上述因素对公司实施募投项目产生不利影响，将可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法消化以及预计效益不能实现，从而对公司经营业绩产生一定不利影响。

（十）新增折旧摊销的风险

本次募集资金投资项目建成后，固定资产、无形资产将大幅增加，公司每年将新增大额折旧摊销费。如果募投项目不能按照原定计划实现预期经济效益，新增折旧摊销费用也将对公司业绩产生一定的不利影响，如公司本次募投项目经营失败，未能给公司带来收益，则公司存在因折旧摊销费用大量增加而导致业绩下滑的风险。

目录

发行人声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况	2
二、特别风险提示	4
目录.....	8
释义.....	10
一、普通术语	10
二、专业术语	11
第一节 发行人基本情况.....	12
一、公司基本信息	12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	12
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	13
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	25
五、现有业务发展安排及未来发展战略	38
六、财务性投资情况	39
七、合法合规及诉讼、仲裁情况	44
八、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况	45
第二节 本次证券发行概要	46
一、本次发行的背景和目的	46
二、发行对象及与发行人的关系	48
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	49
四、本次发行是否构成关联交易	51
五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	52
六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件	52
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	52
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	53
一、本次募集资金投资计划	53
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	53

三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	61
四、本次募投项目其他相关情况	65
五、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响	67
六、本次募集资金使用的可行性分析结论	67
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	69
一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响情况	69
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	70
三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	70
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	70
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ..	70
第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况	72
一、最近五年内募集资金运用基本情况	72
二、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	72
三、公司历次融资募集资金情况	72
第六节 与本次发行相关的风险因素	75
一、行业风险	75
二、经营风险	75
三、财务风险	77
四、其他风险	79
第七节 与本次发行相关的声明	80
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明	80
二、发行人控股股东、实际控制人声明	85
三、保荐人（主承销商）声明	86
四、发行人律师声明	89
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明	90
六、发行人董事会的有关声明	92

释义

一、普通术语

公司、本公司、发行人、信维通信	指	深圳市信维通信股份有限公司
本次发行、本次发行股票	指	深圳市信维通信股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
本募集说明书	指	《深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书》
北京信维	指	信维创科通信技术（北京）有限公司
亚力盛	指	深圳亚力盛连接器有限公司
江苏信维	指	信维通信（江苏）有限公司
艾利门特	指	深圳艾利门特科技有限公司
信维微电子	指	深圳市信维微电子有限公司
精信同丰	指	深圳市精信同丰通信技术有限公司
维仕科技	指	维仕科技有限公司
维仕声学	指	深圳市维仕声学有限公司
伊高得	指	伊高得表面处理（深圳）有限责任公司
友维聚合	指	友维聚合（上海）新材料科技有限公司
聚永昶	指	江苏聚永昶电子科技有限公司
深圳信维智能	指	深圳市信维智能装备技术有限公司
江苏信维智能	指	江苏信维智能汽车互联科技有限公司
江苏信维感应	指	江苏信维感应材料科技有限公司
益阳信维	指	信维通信（益阳）有限公司
安化信维	指	信维电子（安化）有限公司
香港信维	指	香港信维通信有限公司
香港亚力盛	指	亚力盛科技（香港）有限公司
香港声学	指	香港声学科技有限公司
瑞典信维	指	SUNWAY COMMUNICATION AB
美国信维	指	SUNWAY COMMUNICATION INC
韩国信维	指	SUNWAY COMMUNICATION KOREA CO., LTD
日本信维	指	信维通信日本株式会社
越南信维	指	SUNWAY COMMUNICATION VIETNAM COMPANY LIMITED
墨西哥信维	指	SUNWAY COMMUNICATION MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
新加坡信维	指	SINGAPORE SUNWAY COMMUNICATION PTE. LTD.
绵阳北斗	指	绵阳北斗电子有限公司

德清华莹	指	中电科技德清华莹电子有限公司
益阳电科	指	信维电子科技（益阳）有限公司
定价基准日	指	本次向特定对象发行股票的发行期首日
《公司章程》	指	《深圳市信维通信股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东会、董事会	指	深圳市信维通信股份有限公司股东会、董事会
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
保荐机构（主承销商）、申港证券	指	申港证券股份有限公司
发行人律师、康达	指	北京市康达律师事务所
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年一期	指	2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月

二、专业术语

AI	指	“Artificial Intelligence” 的缩写，即人工智能
5G/6G	指	分别指“第五代移动通信技术”和“第六代移动通信技术”
SIA	指	“Satellite Industry Association” 的缩写，指美国卫星产业协会
EEA	指	“Electrical/Electronic Architecture” 的缩写，指汽车电子电气架构，即整车的电子电气系统总设计，包括硬件、软件、通信网络与能量分配的整体布局
FPC	指	“Flexible Printed Circuit” 的缩写，即软性印制电路
LCP	指	“Liquid-Crystal Polymer” 的缩写，即液晶聚合物，是一种新型软性印制电路的基础材料
AiP	指	“Antenna in Package”，是一种基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的技术
TIM	指	“Thermal Interface Material” 的缩写，即导热界面材料，用于填充电子元器件微观缝隙，提高导热效率
TIM1	指	一级界面材料，位于芯片裸晶与集成散热盖之间，直接接触热源，对导热性能要求最高
MLCC	指	“Multi-Layer Ceramic Capacitor” 的缩写，即多层片式陶瓷电容器，由交替堆叠的陶瓷介质层和金属内电极共同烧结而成一个整体，外部通常由金属端电极封装，是一种微型化、高性能、高可靠性的基础电容

注：本募集说明书中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。如无特别说明，本募集说明书中所引用的公司财务数据与财务指标均为合并报表口径。

第一节 发行人基本情况

一、公司基本信息

截至本募集说明书出具日，公司基本情况如下：

公司名称	深圳市信维通信股份有限公司
英文名称	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO.,LTD.
股票上市交易所	深圳证券交易所
公司股票简称	信维通信
公司股票代码	300136
法定代表人	彭浩
实际控制人	彭浩
董事会秘书	卢信
成立日期	2006 年 4 月 27 日
注册地址	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A.B 栋
联系地址	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼
总股本	967,568,638 股
电话	0755-33086079
传真	0755-36869688
电子信箱	ir@sz-sunway.com
经营范围	一般经营项目：移动终端天线、3G 终端天线、模组天线、3D 精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）公司的股本结构

截至 2025 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下：

股份性质	持股数量（股）	股权占比
一、有限售条件股份	144,851,483	14.97%
二、无限售条件股份	822,717,155	85.03%
三、股份总数	967,568,638	100.00%

（二）公司前十大股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	限售股份（股）
1	彭浩	188,503,533	19.48%	141,377,650
2	全国社保基金一零三组合	38,000,000	3.93%	-
3	中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	17,202,796	1.78%	-
4	中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,084,700	1.46%	-
5	香港中央结算有限公司	11,985,183	1.24%	-
6	莱恩达集团有限公司	8,200,882	0.85%	-
7	安耐德合伙人有限公司－客户资金	7,765,946	0.80%	-
8	易建东	6,819,507	0.70%	-
9	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	5,971,680	0.62%	-
10	中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	5,834,198	0.60%	-
合计		304,368,425	31.46%	141,377,650

（三）控股股东及实际控制人基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司股东彭浩先生直接持有公司 188,503,533 股股份，持股比例为 19.48%，为公司控股股东、实际控制人。

（四）控股股东所持公司股份存在质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司股东彭浩先生直接持有公司 188,503,533 股股份，其持有发行人的股份不存在质押、冻结或潜在纠纷的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

发行人目前主营业务所属行业的基本情况如下：

（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类，发行人所属行业为“制造业”（分类代码为 C）下属的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，细分行业为“C392 通信设备制造”。从细分行业来看，发行人业务属于通信设备制造业中的天线及射频元器件行业。

1、行业主管部门与监管体制

公司所属行业规划管理部门为工业和信息化部，主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

工业和信息化部对通信设备制造业的管理仅限于产业政策及行业标准制定、行业发展规划等宏观管理，中国电子元件行业协会进行自律规范，行业内企业的生产经营主要以市场化方式进行。

序号	部门	简介
1	工业和信息化部	制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议等
2	中国电子元件行业协会	行业内企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要工作是通过民主协商、协调，为行业的共同利益，发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用

2、主要法律法规及产业政策

通信设备制造业所涉及的主要法律法规如下：

序号	法律法规	发布机构	发布 / 最新修订
1	《中华人民共和国电信条例》	国务院	2000 年 / 2016 年
2	《中华人民共和国无线电管理条例》	国务院、中央军委	1993 年 / 2016 年
3	《中华人民共和国无线电频率划分规定》	工业和信息化部	2006 年 / 2023 年
4	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》	发改委、工业和信息化部等 8 个部委联合发布	2016 年（未有修订）

通信设备制造业所涉及的主要发展政策如下：

序号	时间	颁布部门	文件名称	相关内容
1	2025 年 10 月	第二十届中央委员会第四次全体会议	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年	培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。完善产业生态，

序号	时间	颁布部门	文件名称	相关内容
			规划的建议》	实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加快新兴产业规模化发展。前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。
2	2025 年 8 月	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	加快提升新一代整机装备供给能力，推动 5G/6G 关键器件、芯片、模块等技术攻关，加强 6G 技术成果储备。
3	2025 年 5 月	国家数据局综合司	《数字中国建设 2025 年行动方案》	深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。着力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备。
4	2025 年 5 月	工信部、国家发改委、国家数据局	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	加快先进通用技术推广应用。以整机产品和系统创新带动产业链配套体系优化完善，打造先进计算、人工智能、虚拟现实等数智技术应用标杆，加快全产业链数字化转型、智能化升级。鼓励应用智能感知、虚拟现实、增强现实、沉浸音频等技术推动实数融合应用创新，加快智能可穿戴设备、智能机器人等创新产品试用推广。
5	2024 年 11 月	工信部、中央网信办、国家发改委等十二部门	《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》	大力推动 5G 应用规模化发展，加快培育新质生产力，带动新一代信息技术全方位全链条普及应用，壮大经济社会高质量发展新动能。统筹高质量发展和高水平安全，发挥 5G 牵引作用，着力推动数字技术融合创新，实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能，持续增强 5G 规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力，支撑新型工业化和信息通信业现代化，为建设网络强国、推进中国式现代化构筑坚实物质技术基础。
6	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	明确将信息产业中“新型电子元器件制造”、“电子元器件生产专用材料”列为鼓励类产业。
7	2023 年 8 月	工信部、国务院国资委	《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》	液态金属：熔点在室温附近的金属或合金，集金属与流体特性于一体，同时具有导电性强、热导率高、液态温区宽等特点，包括镓基液态金属、铋基/锑基/锡基低熔点合金、功能性液态金属复合材料等。
8	2023 年 2 月	中共中央、国务院	《质量强国建设纲要》	推进特种材料、功能材料、复合材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关。
9	2022 年 12 月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》	加快建设信息基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。以需求为导向，增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。 加快培育新型消费。丰富 5G 网络和千兆光网应用场景。加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用。
10	2021 年 3 月	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	加快建设新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。

序号	时间	颁布部门	文件名称	相关内容
11	2020 年 11 月	国务院	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	推进新一代无线通信网络建设，加快基于蜂窝通信技术的车辆与车外其他设备间的无线通信（C-V2X）标准制定和技术升级。推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级，加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联，推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。加快差分基站建设，推动北斗等卫星导航系统在高精度定位领域应用。
12	2020 年 2 月	国家发展改革委、工信部、科技部等十一部委	《智能汽车创新发展战略》	突破关键基础技术。开展复杂系统体系架构、复杂环境感知智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等基础前瞻技术研发，重点突破新型电子电气架构、多源传感信息融合感知、新型智能终端、智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、云控基础平台等共性交叉技术。推动新技术转化应用。开展军民联合攻关，加快北斗卫星导航定位系统、高分辨率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用，促进车辆电子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷达、微机电系统、惯性导航系统等自主知识产权军用技术的转化应用，加强自动驾驶系统、云控基础平台等在国防军工领域的开发应用。

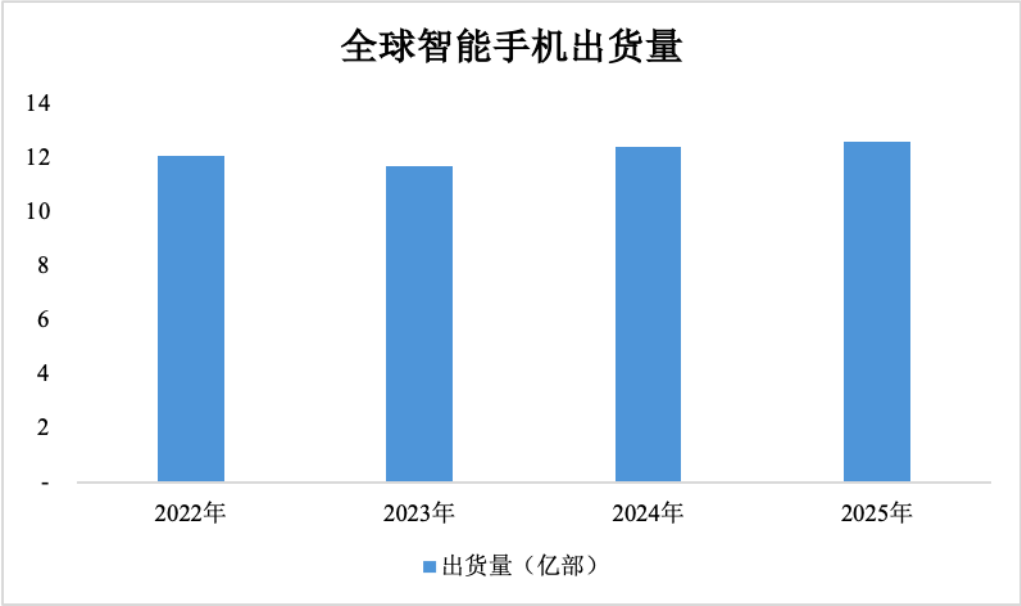
（二）行业概况及发展前景

1、行业概况

信息通信行业是构建国家信息基础设施，是提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。近年来，全球信息通信产业保持了高速发展，移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术加快革新，行业内各项新产品和新应用层出不穷。随着各国对信息通信基础设施投资力度的持续加大，以及消费电子、智能汽车、商业卫星等下游领域的快速发展，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等传统移动终端产品持续向高端化、智能化升级，卫星通信终端、车载智能终端等新型终端加速普及，全球终端市场保持稳健发展态势。

在消费电子领域，以手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、TWS 耳机、XR 等终端产品为典型代表，2025 年仍保持增长态势，同时呈现高端化、智能化、多元化的创新变革特征，市场发展韧性持续凸显，为上游天线及射频元器件等配套产业提供了稳定的需求支撑。根据 IDC 数据，2025 年全球智能手机出货量达 12.6 亿部，同比增长 1.9%，头部厂商市场份额进一步集中，行业高端化趋势愈发明显；在智能穿戴设备方面，2025 年前三季度全球腕戴设备市场出货 1.5 亿台，同比增长 10.0%，其中中国市场累计出货量为 5,843 万台，同比增长 27.6%。根据 Omdia 数据，2025 年全球 PC 出货量突破 2.7 亿台，同比增长 9.2%。

整体来看，全球消费电子市场已逐步进入稳健复苏与高质量发展的新阶段。AI 技术的深度渗透、折叠屏等新型显示技术的持续成熟、高端化消费需求的不断释放，以及新兴品类的快速崛起，共同推动消费电子市场的结构优化与价值提升，也为上游射频天线、无线充电、EMI/EMC 器件等配套元器件产业的持续发展注入了强劲动力。

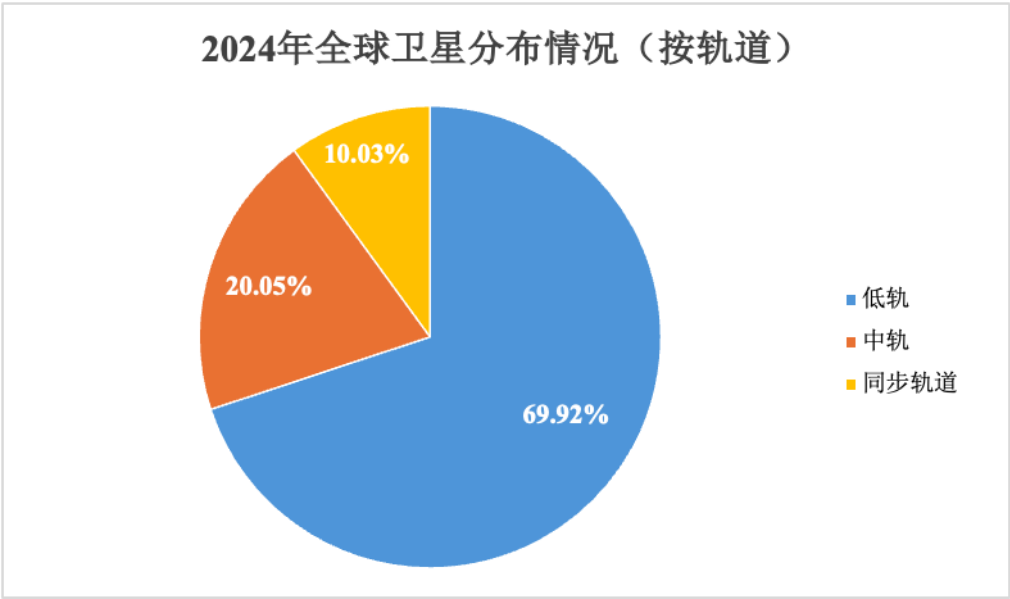


数据来源：IDC

在物联网领域，受益于 5G、人工智能和传感器等技术的驱动，整个行业已进入新一轮发展期。其中，智能家居作为物联网产业中具有代表性的消费级应用场景，因其市场化程度高、需求韧性强，从而为上游配套元器件产业开辟了广阔的市场空间。根据 IoT Analytics 数据，2024 年是全球 IoT 硬件相对淡季，但联网设备的数量却同比增长约 13%，数量超过 180 亿台。进入 2025 年，全球物联网市场增长势头进一步提速，联网设备数量持续攀升，全球联网 IoT 设备预计达到约 211 亿台，同比增长约 14%。在智能家居细分领域，受益于国内政府促消费补贴政策持续发力、居民家电换新需求持续释放及 AI 智能化技术的深度渗透，市场保持稳健增长态势。根据 IDC 数据，2025 年中国智能家居市场全年出货预计达 2.79 亿台，同比增长 4.6%。

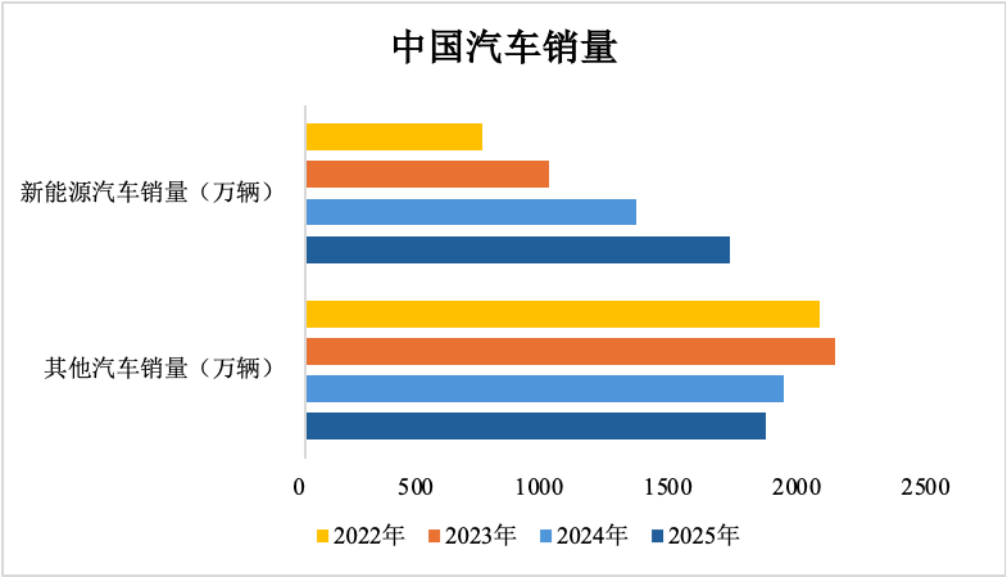
在商业卫星领域，商业卫星通信是以卫星作为中继实现地球上的无线电通信站间的通信，卫星互联网是近几年快速发展的互联网通信形式。越来越多的国家启动了商业卫星通信项目的建设，特别是在有些大量连接需求处于偏远地区的国

家，商业卫星通信成为重要的连接手段。根据 SIA 数据，2024 年全球航天经济收入达到 4,150 亿美元，其中商业卫星产业继续占据主导地位，规模增至 2,930 亿美元，占航天经济总量的 71%。低轨卫星凭借低时延、高信号强度、广覆盖、低成本等优势，成为各国布局重点。随着数据传输及单颗卫星带宽等技术的突破，预计低轨商业卫星通信市场还将继续保持增长态势。而通信技术的发展，将实现卫星互联网与地面通信网络的深度融合，构建天地一体化的通信网络，为用户提供更加无缝、高效的通信服务。



数据来源：北京空间科技信息研究所、招商证券

在智能汽车领域，我国汽车市场整体发展持续向好，消费者对汽车智能化、电气化的需求以及技术革新为汽车市场的发展注入核心动力。根据中国汽车工业协会数据，2025 年，我国汽车销量达到 3,440 万辆，同比增长 9.4%，连续 17 年稳居全球第一。其中新能源汽车销量达到 1,649 万辆，同比增长 28.2%，连续 11 年位居全球第一。新能源汽车作为智能汽车市场的重要组成部分，随着渗透率的持续提升将进一步推动汽车智能化进程。智能汽车在政策、产业链协同及技术升级驱动下，智能化、网联化的不断提高将对射频器件的用量和性能提出更高的要求，带来更高的产品附加值。



数据来源：中国汽车工业协会

2、行业发展前景

(1) 通信设备产业迎来智能化、空天地一体化发展新机遇

通信设备作为信息通信技术的核心载体，是全球数字化转型与智能化升级的核心基石，依托 5G-A 商用落地、6G 技术研发提速，叠加人工智能、物联网、卫星通信等技术深度融合，行业未来将向智能化、算力化、空天地一体化深度演进。

政策层面，国内产业支持力度持续加码。继“十四五”规划明确 5G 与千兆光网建设目标后，政策重心逐步向算力网络、工业互联网与移动物联网倾斜。2024 年 8 月，工信部发布的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》明确到 2027 年国内“移动物联网终端连接数力争突破 36 亿”；2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确“支持智能化研发工具和平台推广应用，加强人工智能与生物制造、量子科技、第六代移动通信（6G）等领域技术协同创新，以新的科研成果支撑场景应用落地，以新的应用需求牵引科技创新突破。”；2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，其中提出，鼓励各地推动人工智能终端创新应用，推动 5G/6G 关键器件、芯片、模块等技术攻关。叠加“十五五”规划将通信设备列为战略性新兴产业重点方向，持续的政策红利为行业筑牢了长期需求基础。

技术演进方面，行业将迎来持续的升级机遇。2026 年起，5G 网络建设进入“深覆盖、优体验”的深化阶段，5G-A 的通感一体、无源物联等关键特性将逐步从技术验证走向商用试点，推动行业应用规模化落地。同时，6G 研发已进入技术方案验证期，太赫兹通信、智能超表面、天地一体化组网等前沿技术正逐步从实验室走向外场测试。根据 Research And Markets 数据，2024 年全球 6G 技术市场规模为 16.6 亿美元，预计 2030 年将增至 149.4 亿美元，年均复合增长率高达 43.98%。

（2）政策密集赋能，卫星通信产业化进程提速

在数字经济渗透、空天地一体化网络建设加速的背景下，商业卫星通信作为国家信息基础设施核心、6G “万物互联”的关键支撑，已成为推动通信产业升级、保障信息安全的战略新兴领域。近年来，我国出台密集产业政策，从顶层设计到应用推广构建全方位支持体系，引领产业迈入规范化、商业化快速发展阶段。

2025 年 8 月，工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出持续开展卫星通信关键核心技术攻关和产品研制，增强基础元器件、芯片、关键终端设备产品等供给水平，提升卫星通信技术性能，降低用户使用成本，推动我国卫星通信技术持续迭代演进；促进卫星通信、5G/6G、人工智能等新一代信息通信技术深度互融，加快推进非地面网络（NTN）等卫星通信技术创新发展。2025 年 9 月，工信部向中国联合网络通信集团有限公司颁发卫星移动通信业务经营许可，标志着我国卫星通信产业从技术验证已开始迈向商业化运营。

随着政策落地、技术突破与场景拓展，我国商业卫星通信产业将加速发展，满足国内需求、助力国家战略，同时提升全球竞争力，实现产业高质量发展与国家战略同频共振。

（3）卫星互联网产业市场规模逐步扩大，地面设备收入占比较高

卫星互联网产业链主要包含了卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节，其中地面设备制造业和卫星服务业是产业收入主要构成。卫星地面设备是指用于与卫星进行通信、控制、监测和数据传输等一系列活动的地面设施和设备。卫星地面设备是卫星系统的重要组成部分，确保了卫星能够正常运行

并发挥其功能，实现各种应用，如通信、导航、遥感等。根据 SIA 数据，2024 年全球卫星产业实现收入 2,930 亿美元，其中地面设备收入 1,553 亿美元，占卫星产业总收入的 53%。

（4）AI 技术创新应用，推动消费电子行业发展

近年来，人工智能技术持续迭代、不断取得突破性进展，在数据处理、人机交互、文本及视频生成等多个领域展现出显著技术优势，并逐步向消费电子领域渗透应用。海内外科技企业纷纷布局 AI 消费电子赛道，相继推出 AI 手机、AI 眼镜等多款创新产品，推动消费电子终端向智能化、场景化升级。根据艾瑞咨询数据，全球 AI 眼镜市场将保持高速增长态势，预计 2028 年全球、中国 AI 眼镜出货量将分别达到 2,600 万台、972 万台，2023—2028 年复合增长率（CAGR）超过 100%，成为 AI 消费电子领域的增长亮点。在 AI 技术的持续赋能下，消费电子行业整体有望迎来全新发展机遇，未来消费电子市场将持续涌现各类创新终端产品，行业将正式迈入新一轮发展阶段，市场规模有望持续扩大。

（5）智能汽车变革下单车电子价值提升，天线需求增长打开产业新空间

新能源汽车的变革围绕电动化、智能化、网联化、共享化四大核心趋势展开，其中智能化和网联化是提升单车电子元件价值、催生全新供应链的核心驱动力，推动着汽车 EEA 重构。传统燃油车的 EEA 相对分散，电子成本占比较低，而智能电动汽车由于需要搭载高算力计算平台、高精度传感器以及复杂的射频通信系统，使得单车电子价值量显著提升，为射频通信、高性能连接、无源器件等细分领域带来发展机遇。

在汽车天线方面，随着汽车智能化水平的提升，单车对天线的需求量显著增加。相较于传统燃油车平均 3-4 根天线的配置，支持 L2+级自动驾驶功能的智能汽车所需天线数量已增至 6-8 根，且技术架构从单一功能的离散设计向多频段高度融合和智能波束赋形等方向快速演进。在智能化趋势持续深化与新能源汽车普及率不断提高的双重驱动下，汽车天线行业迎来重要发展契机。

（三）公司的竞争优势和行业竞争格局

1、公司的竞争优势

（1）优秀的技术研发能力

为了更好地把握行业技术发展趋势、满足客户的产品需求，公司一直高度重视技术研发，坚持对基础材料、基础技术的投入，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。公司持续保持着高强度的研发投入，不断深化“材料—零部件—模组”的一站式研发创新能力，为客户提供专业、高品质、多样化的产品与解决方案。公司已在中国深圳、北京、上海、常州、绵阳，以及美国、日本、韩国、瑞士、瑞典等多个国家和地区设立技术研究中心，不断引入全球高端技术人才，打造以基础材料和基础技术为核心、以中央研究院为主体的全球化综合性研发体系，并通过与国内外知名高校、科研院所、企业开展长期、深入、紧密的战略合作，不断提升自主创新能力，打造跨学科、跨领域的技术及知识体系，形成综合性技术优势，为公司未来快速成长奠定基础。

公司高度重视基础材料和基础技术研发，通过对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料领域持续进行高强度研究投入，提升了 5G-A/6G 天线、无线充电模组及相关产品、高性能精密连接器、被动元件、UWB 模组等产品的竞争力，通过为客户提供多样化、定制化、高附加值的创新型产品与解决方案，持续为客户创造价值并保持公司行业领先的技术地位。

（2）长期稳定的大客户平台

历经多年发展，发行人凭借自身的技术、研发积累和稳定、高效的产品供应，逐步切入世界一流品牌厂商的供应商渠道。在高度关注且充分理解客户真正需求的基础上，公司已经搭建了优质的全球大客户平台，并持续与客户保持良好的合作关系。凭借稳定的品质、及时的交付、有竞争力的产品，获得了客户的高度认可。凭借对基础材料、基础技术的持续投入，公司技术能力受到客户的重视，公司定期与全球大客户展开技术交流，增加了大客户的黏性与新技术的洞察力。

（3）持续优化的管理能力

近年来公司不断深化精益管理，通过自主研发提高自动化生产水平，不断革新传统制造工艺，做好成本管控。随着公司经营规模的持续扩大，公司不断提升运营管理和技术工艺创新能力，快速响应客户的需求，从生产效率、产品质量、安全保障等方面入手着力提升制造能力，从而保证了公司产品的品质、产能的高效利用、客户的满意。通过智能工厂建设，实现工厂全面数据化管理，优化了生

产运营管理效率，并满足了不断增长的定制化客户需求。

(4) 不断完善与加强的公司领导力

公司持续深化各事业部的战略发展规划及预算管理，不断根据市场及客户的变化作出调整与应对措施。在组织建设方面，通过对事业部制的深化与改革，构建了更为完善的组织架构，加强公司在财务、人事、风险管控、信息共享等方面的管控，在确保对整体运营风险管控的同时，做到事业部运营的灵活性、内部决策的高效性，并做到上下同欲，以适应公司快速发展的组织需要。此外，公司大力提拔年轻干部，引进相应的技术及管理人才，人才结构得到了优化，通过企业文化、领导力、战略经营等多方面的培训班、训练营等方式，帮助核心骨干团队实现了快速成长；经过对 EMT 集体领导、集体决策制度的持续完善，决策机制不断优化，战略能见度以及接班人梯队的培养实现了明显提升，更好地应对日益复杂的全球商业环境和内部管理挑战；长期坚持信维合伙人文化的理念，继续完善绩效考核评价体系及股权激励等长效激励机制，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现稳步发展。

(5) 全球顶尖产业协会成员，领先的产业实现能力

公司目前已加入国际无线产业联盟（IWPC），同时还是全球最具权威的无线通信产业和移动生态系统协会（美国无线通信和互联网协会，CTIA）、欧洲 3D-MID 协会、无线充电联盟（WPC）、中国通信学会（CIC）、FiRa 联盟、汽车数字连接协会（Car Connectivity Consortium）等多个行业协会的重要成员。公司凭借专业的射频技术，通过与业内一流企业的持续合作，共同制定相关方法标准等，积极开展通信技术前沿研究与产业化应用，推动自主创新，加速科技成果转化。公司拥有广东省 LCP 5G 射频系统工程技术研究中心以及深圳市 5G 毫米波天线技术工程实验室，测试能力达到国际领先水平。

2、行业竞争格局

公司所处行业属于技术密集型产业，呈现“国际巨头主导、国内龙头崛起”的竞争格局。在全球范围内，以村田（Murata）、安费诺（Amphenol）为代表的国际领先企业凭借其在基础材料、高频技术及全球客户资源方面的深厚积累，长期占据高端市场主导地位。与此同时，以公司为代表的国内龙头企业，通过持续

的技术创新与垂直整合，在消费电子、商业航天及汽车电子等细分领域快速崛起，市场份额持续提升，逐步实现对部分高端产品的国产替代。

在细分领域，竞争态势呈现差异化特征。在消费电子领域，竞争较为激烈，企业主要围绕大客户资源、产品良率及交付能力展开角逐；在商业航天及汽车电子等新兴领域，技术壁垒高，具备材料自研能力、极端环境适配能力及高端认证资质的企业构筑了较强的护城河，市场集中度相对较高。发行人通过持续的研发投入和技术创新，构建了从材料研发到产品设计、精密制造的一站式服务能力，形成了较强的技术护城河。目前，公司已与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、商业航天及汽车电子等领域，具备较强的市场竞争力和品牌影响力。

以发行人主要业务作为参考标准，并综合考虑业务规模、盈利能力后，选取的同行业可比公司如下：

公司名称	主营业务介绍
歌尔股份	歌尔股份主要从事精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主要产品包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件，以及VR虚拟现实、MR混合现实、AR增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家用电子游戏机及配件、智能家居等智能硬件产品。
立讯精密	立讯精密主要从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。致力于为消费电子产品（智能手机、智能可穿戴设备、混合虚拟现实设备、声学模组、无线充电模组、LCP天线、震动马达、VCM等）、汽车领域产品（汽车线束、汽车连接器、智能座舱、智能驾驶等）以及企业通讯产品（高速互联、光模块、散热模块、电源、基站天线、基站滤波器等）提供从核心零部件、模组到系统组装的一体化智能制造解决方案。
领益智造	领益智造在全球范围内为客户提供精密功能件、结构件、模组等一站式智能制造服务及解决方案。其精密功能件产品的市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位，在质量、制程、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透机器人、新能源汽车、光伏储能等新兴市场。
长盈精密	长盈精密是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件，新能源汽车零组件，工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。主要产品包括消费类电子精密结构件及模组、新能源产品零组件及连接器、电子连接器及智能电子产品精密小件等。
安洁科技	安洁科技主要服务于全球消费电子行业、新能源汽车行业以及信息存储行业领先客户，为客户提供精密功能性器件、精密结构件和模组类产品，以及相关设计研发和生产制造服务。产品主要用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品及新能源汽车和信息存储设备等智能终端。
蓝思科技	蓝思科技是智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，业务涉及智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等产品的结构件、功能模组、整机组装等，涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、皮革、玻纤、碳纤维等材料，以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统等。
飞荣达	飞荣达主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，致力成为ICT领域新材料及智能制造领先企业。

注1：可比公司均为申银万国三级行业分类“消费电子零部件及组装”行业内公司；

注2：上表中信息来自于各公司网站、招股说明书、年度报告等公开信息。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主要产品简介

公司主营业务覆盖天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI/EMC 器件、高精度连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等，客户涵盖全球多家知名科技企业，为客户提供“材料—零部件—模组”的一站式解决方案，应用领域包括消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等。其中，消费电子是公司目前主要的下游应用市场，商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居是公司新兴的重要下游应用市场。

公司积极把握 5G-A/6G、数据中心、人工智能等技术创新趋势，将技术驱动融合在产品服务中，保持技术创新活力。

在材料方面，公司持续夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强技术投入。在高分子材料领域，公司开发的 LCP 薄膜、LCP 柔性覆铜板、MPI 柔性覆铜板等产品已在国内外客户 RF 传输线、毫米波传输线、UWB 天线等领域应用量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，具有耐高温、高频低损耗等优点，在 5G 通信领域产品中已有大量使用，同时公司开展 6G 前沿技术及先进材料研发，应用前景更加广阔。在磁性材料上，公司开发的高频高功率低损耗磁性材料是下一代无线充电核心技术，已应用于国内外客户移动终端发射端；另外，磁性材料还可帮助公司提升天线、射频模组等多类产品的竞争力。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方研发能力，支撑高端 MLCC 产品竞争力；公司研究的高容、宽温陶瓷材料在通信、AI 领域应用良好；公司通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案。在散热材料领域，公司已为北美客户提供芯片封装散热及其他模组散热器件。

在基础技术方面，公司依托中央研究院为核心的全球 11 个研发中心，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等；在无线充电领域，储备 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术；在高速连接器领域，研发满足高频高速需求

的轻量化、高频低损耗介电材料。

未来，公司将继续积极把握产业创新机会，坚持对基础材料、基础技术的投入，不断提升企业核心竞争力、加强运营能力，努力成为“产品领先+卓越运营”的技术驱动型企业。

（二）主要经营模式

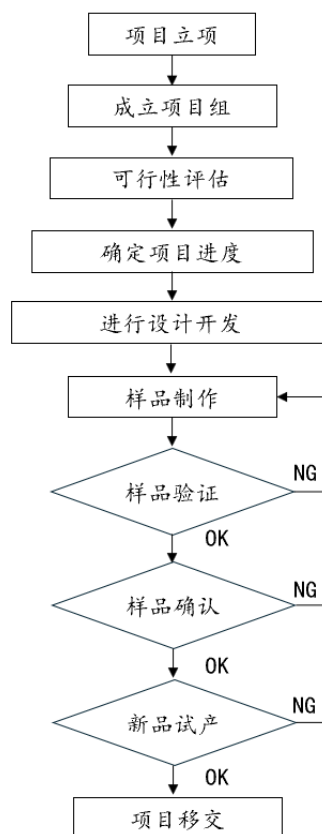
发行人所处行业的主要客户为消费电子品牌商及相关 OEM/ODM 厂商以及智能网联汽车、商业卫星通信等相关领域客户，下游客户的市场集中度较高，因此公司建立了以大客户为导向的营销、生产和研发体系，积极获取各大客户的供应商资质。

在产品研发环节，射频天线及元器件产品的制式、规格、功能多根据客户的具体需求，以定制化开发为主，产品类别较多；产品生产多采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式，生产过程中涉及到电磁学、材料学、化工工程、机械加工等领域的多种关键技术，产品的技术含量较高，综合性较强；采购运作上，一般以销售订单为基础，确定物料需求，制定采购计划并组织采购。

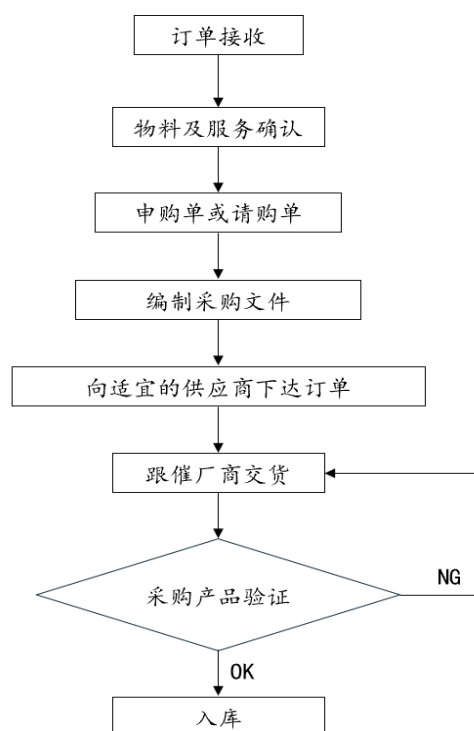
（三）主要业务流程

发行人建立了较为完善的业务流程体系，通过制定内部规章制度，对研发、采购、生产、销售等业务流程进行有效管理，保证发行人主要业务的良好运作。相关业务的典型具体流程如下：

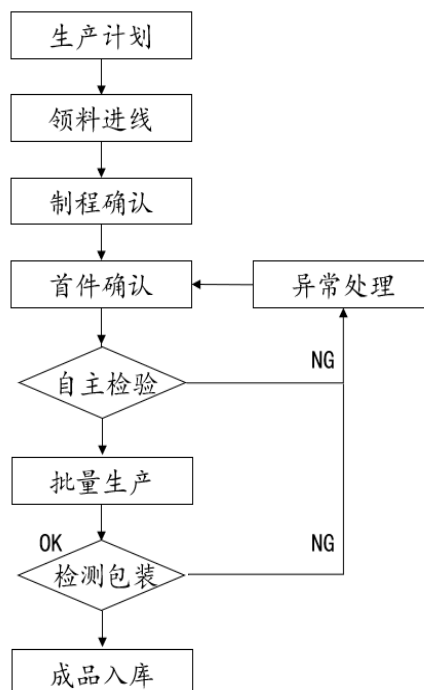
1、研发业务流程



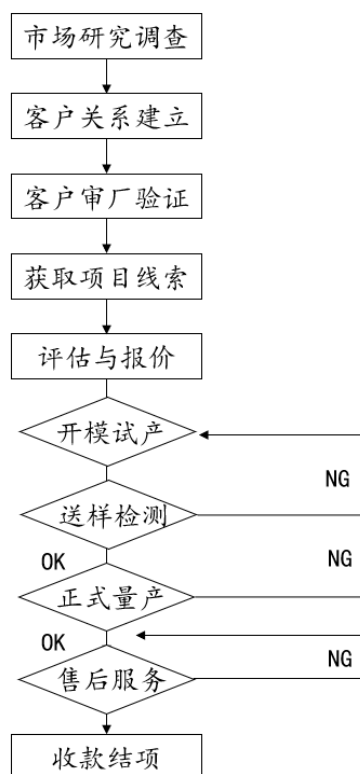
2、采购业务流程



3、生产业务流程



4、销售业务流程



（四）发行人收入分类情况

报告期内，公司营业收入按照产品类别情况如下：

单位：万元/%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
射频零、部件	646,237.27	100.00	874,361.06	100.00	754,764.57	100.00	858,991.66	100.00
合计	646,237.27	100.00	874,361.06	100.00	754,764.57	100.00	858,991.66	100.00

报告期内，公司营业收入按照区域划分如下：

单位：万元/%

地区名称	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	223,491.39	34.58	234,177.90	26.78	140,902.26	18.67	187,070.90	21.78
境外	422,745.88	65.42	640,183.17	73.22	613,862.31	81.33	671,920.76	78.22
合计	646,237.27	100.00	874,361.06	100.00	754,764.57	100.00	858,991.66	100.00

注：境内为人民币结算，境外为外币结算类，包含保税区。

（五）采购及产量、销量情况

1、原材料及能源采购情况

公司产品定制化特征明显，报告期内各项原材料的采购一般以销售订单为基础，确定物料需求，制定采购计划并组织采购。公司与主要的原材料供应商建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原料供货渠道。

公司生产所耗用的主要能源为电力，其价格随各自市场的情况或政府部门的定价而波动。报告期内，能源供应充足，可以保证生产经营需要。

2、主要产品产销情况

单位：万支

项目		2025 年 1-9 月	2024 年	2023 年	2022 年
射频零、部件	生产量	3,283,440.95	2,926,185.64	4,304,925.74	3,070,128.39
	销售量	3,215,635.16	2,898,298.38	4,440,901.28	2,690,999.55
	产销率	97.93%	99.05%	103.16%	87.65%

报告期内，发行人产品的产销率总体保持在较高水平。公司产品销售量、生产量变动幅度较大，主要系受公司电阻产品线的影响，电阻产品具有平均单价低、

产销量大的特点。2023 年产销率高于 100%主要系上期生产的部分产品于本期进行销售所致。

（六）主要固定资产、物业租赁及无形资产

1、固定资产概览

公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、测试设备、运输工具和办公及其他设备等。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司固定资产状况如下：

单位：万元			
项目	原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	112,781.35	91,155.90	80.83%
生产设备	311,776.29	148,476.75	47.62%
测试设备	58,496.60	24,811.11	42.41%
运输设备	2,183.18	660.18	30.24%
办公及其他设备	8,541.77	2,414.18	28.26%
合计	493,779.18	267,518.13	54.18%

2、不动产

(1) 境内不动产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境内不动产共计 863 项，其中已取得不动产权证书 659 项，正在办理不动产权证书 204 项。公司正在办理不动产权证书的房产性质均为住宅或配套车位。

上述境内不动产中，主要用途为工业用地/工业用房情况如下：

序号	权利人	产权证书编号	坐落	权利类型	权利性质	用途	宗地面积/建筑面积 (m²)	权利限制
1	信维通信	粤（2024）深圳市不动产权第 0306089 号	宝安区新桥街道新杰七路与新杰二路交汇处西南侧	国有建设用地使用权	出让	普通工业用地	59,410.90	抵押
2	江苏信维	苏（2025）金坛区不动产权第 0042714 号	金龙大道 369 号	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/自建房	工业用地/其他	237,267.00/260,139.85	无
3	江苏信维	苏（2025）金坛区不动产权第 0042724 号	金龙大道 369 号	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/自建房	工业用地/其他	319,952.00/41,906.18	无
4	北京信维	京技国用（2013 出）第 00041 号/X 京房权证开字第 025598 号	北京市经济技术开发区锦绣街 14 号 1 号楼等 2 幢	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让	工业用地/工业用房	15,595.03/24,620.76	无
5	北京信维	京技国用（2013 出）第 00042 号/X 京房权证开字第 025551 号	北京经济开发区荣昌东街甲 7 号 1 幢等 3 幢	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让	工业用地/工业用房	9,244.60/2,925.63	无

(2) 境外不动产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境外不动产共计 2 项，具体情况如下：

序号	权利人	产权证书编号	坐落	用途	宗地面积/建筑面积 (m²)	权利限制
1	日本信维	0524000363408/0524010104520	筑波市和台 10 号	研发	2,480.01/1,163.49	无

序号	权利人	产权证书编号	坐落	用途	宗地面积/建筑面积（㎡）	权利限制
2	越南信维	DG348280	永福省平川县巴贤镇平川第二工业区	工业用地	9,422.10/5,640.00	无

3、物业租赁

截至本募集说明书出具日，公司及其控股子公司主要承租物业情况如下：

（1）境内租赁

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积（㎡）	租赁期限
1	江苏金东投资发展有限公司	江苏信维感应	儒林产业园内三期标准厂房 1#、2#、3#厂房	工业	18,584.66	2022.6.1-2027.5.30
2	上海开格企业发展有限公司	信维通信	上海市浦东新区沪南路 2655 号	办公	200.00	2024.12.1-2026.11.30
3	上海开格企业发展有限公司	江苏信维智能	上海市浦东新区沪南路 2655 号	办公	728.00	2024.12.1-2026.11.30
4	益阳东创投资建设有限责任公司	维仕科技	益阳高新区东部产业园标准化厂房及配套用房	厂房	28,825.00	2021.1.1-2030.12.31
5	深圳市新桥万丰股份合作公司	艾利门特	宝安区沙井街道南环路 461 号（原 539 号）万丰西部工业区内 B 栋厂房、C 栋宿舍第二至三层及 D 栋宿舍第二层 201 房至 210 房	工业	11,483.00	2021.4.1-2026.10.31
6	深圳市沙井蚝一股份合作公司	艾利门特	深圳市宝安区沙井街道南环路 465 号蚝一西部科技园 A3 厂房 B3 宿舍及配套用房（含发电机房、门卫室、贵宾楼）	厂房、宿舍	11,193.43	2025.6.16-2028.6.30
7	深圳市沙井蚝一股份合作公司	艾利门特	深圳市宝安区沙井街道南环路 467 号厂房、宿舍及附属配套用房	厂房、宿舍	9,394.70	2021.11.1-2026.10.31
8	深圳市沙井蚝一股份合作公司	维仕声学	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 C 栋	厂房	11,679.60	2024.10.1-2028.9.30
9	深圳市新桥万丰股份合作公司	维仕声学	宝安区沙井街道南环路 461 号（原 539 号）万丰西部工业区内办公楼、A 栋宿舍第五至六层及 C 栋宿舍第四至六层	工业	13,379.00	2021.4.1-2026.10.31
10	深圳市新桥万丰股份合作公司	信维通信	宝安区沙井街道南环路 461 号（原 539 号）万丰西部工业区内部分厂房、宿舍及附属建筑物	工业	39,294.00	2021.4.1-2026.10.31
11	深圳市沙井蚝一股份合作公司	信维通信	深圳市宝安区沙井街道南环路西部蚝一科技工业园 A5 厂房、B9	厂房、宿舍	38,648.84	2023.10.1-2028.9.30

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积（m²）	租赁期限
			栋宿舍（部分）			
12	深圳市沙井蚝一股份合作公司	信维通信	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A、B 栋厂房（含宿舍及配套用房）	厂房、宿舍	55,231.15	2024.10.1-2028.9.30
13	深圳市全升昌实业有限公司	伊高得	深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园 A-3 区厂房_二楼 2 车间	工业	2,595.00	2024.4.1-2026.6.30
14	深圳市恒荣昌实业有限公司	伊高得	深圳市宝安区沙井街道共和社区第二工业区 A 区第一栋三层厂房、第八栋宿舍的第 2-5 层、第八栋宿舍第 1 层的 3 间铺位及相关的配套设施	工业	7,055.00	2023.4.1-2027.12.31
15	深圳市特发信息股份有限公司	信维通信	深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港 A 栋 1 层北 101-110、2 层整层	科研办公	2,443.56	2025.1.1-2026.12.31
16	深圳市瑞丰创新产业园投资管理有限公司	信维通信	深圳市南山区桃源街道珠光社区珠光路珠光创新科技园 2 栋 103/105/107/109 的房屋	研发	410.00	2026.1.1-2026.12.31

（2）境外租赁

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	租赁面积	租赁期限
1	Imas 有限公司	日本信维	大阪府東大阪市今米 2 丁目 8 番地 19 号	研发	1,735.05 m²	2023.11.1-2028.10.31
2	赤水住宅夏美松 PM 东京株式会社	日本信维	神奈川県横浜市中区本町 1 丁目 4 番地	办公	84.44 m²	2025.10.1-2028.9.30
3	金俊成、李良淑	韩国信维	京畿道水原市灵通区新园路 88 号, 101 栋 801 号（新洞, 第二数码帝国大厦 2 期）	工厂	182.83 m²	长期
4	池柳廷	韩国信维	京畿道水原市灵通区新园路 88 号, 101 栋 802 号（新洞, 第二数码帝国大厦 2 期）	工厂	148.84 m²	长期
5	申贵熙	韩国信维	京畿道水原市灵通区新园路 88 号, 101 栋 809 号（新洞, 第二数码帝国大厦 2 期）	工厂	162.26 m²	长期
6	Cupertino City Center Buildings	美国信维	20400 Stevens Creek Blvd, Suite 100 Cupertino, CA95014	办公	7,597 ft²	2020.10.23-2031.5.31
7	JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY	美国信维	10180 Telesis Court, Ste 165 and Ste 220, San Diego, CA 92121	办公	11,794 ft²	位于 Ste 165 的物业租期为 2025.3.1-2027.6.30； 位于 Ste 220 的物业租期

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	租赁面积	租赁期限
						为 2022.2.1-2027.6.30
8	H. G. FENTON PROPERTY COMPANY	美国信维	6195 Cornerstone Court, Suite 104, San Diego, CA 92121	办公、研发、实验室	1,210 ft²	2022.4.15-2027.5.31
9	Nancy Ridge Technology Center, L.P.	美国信维	6330 Nancy Ridge Drive, Suite 101, San Diego, CA 92121	办公	3,700 ft²	2023.2.15-2028.3.31
10	HOMERO SEPULVEDA GARCIA	墨西哥信维	墨西哥新莱昂州佩斯科里亚市罗赫略·佩雷斯·阿兰比德大道 4502 号佩斯科里亚工业园区仓库 A 与 E	厂房	4,000 m²	2023.9.1-2027.8.31
11	Goldex (HK) Technology Ltd	香港信维	九龍新蒲崗雙喜街 1 號安田中心 17 樓 1701 室	办公	-	2024.12.1-2026.12.30
12	CNCTECH Thang Long Joint Stock Company	越南信维	Lot I26-A, Ba Thien Industrial Park – Zone 1, Binh Xuyen Commune, Phu Tho Province	厂房	30,030 m²	2023.9.1-2028.8.31
13	CNCTECH Thang Long Joint Stock Company	越南信维	Lot I26-A, Ba Thien Industrial Park – Zone 1, Binh Xuyen Commune, Phu Tho Province	厂房	15,015 m²	2024.9.16-2029.9.15
14	Areim Kista 1 AB	瑞典信维	瑞典斯德哥尔摩 Isafjordsgatan31	办公	315 m²	2013.2.1-2027.1.31

4、主要无形资产情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司主要无形资产情况如下：

- （1）专利：截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境内专利共计 3,347 项，拥有的境外专利共计 35 项；
- （2）商标：截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境内注册商标共计 76 项，拥有的境外商标共计 22 项；
- （3）计算机软件著作权：截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境内计算机软件著作权共计 19 项；
- （4）作品著作权：截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司拥有的境内作品著作权共计 4 项。

（七）主要经营资质、许可

截至本募集说明书出具日，公司及其境内控股子公司取得的主要经营资质、许可情况如下：

（1）报关单位备案

序号	业务资质持有人	证书名称	海关备案编码	所在地海关	许可事项	有效期
1	信维通信	报关单位备案	4403963859	福强海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
2	北京信维	报关单位备案	111326045U	亦庄海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
3	江苏信维	报关单位备案	3204966887	常州海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
4	亚力盛	报关单位备案	4403160BN4	福中海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
5	信维微电子	报关单位备案	4403161K4M	福中海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
6	艾利门特	报关单位备案	4403160XP3	福中海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
7	安化信维	报关单位备案	430996299Z	益阳海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
8	精信同丰	报关单位备案	4403962Q85	福中海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
9	深圳信维智能	报关单位备案	4403161L4T	福中海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
10	江苏信维智能	报关单位备案	3204966A5A	常州海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
11	聚永昶	报关单位备案	3204966ABS	常州海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
12	友维聚合	报关单位备案	3112962C9T	吴淞海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
13	江苏信维感应	报关单位备案	3204966A8T	常州海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31
14	维仕科技	报关单位备案	430936280B	益阳海关	进出口货物收发货人	至 2099/12/31

（2）排污许可或固定污染源排污登记

序号	业务资质持有人	证书名称	证书编号	发证部门	颁发/登记日期	有效期
1	北京信维	排污许可证	91110302600091938T001X	北京经济技术开发区行政审批局	2023.12.28	2023.12.28-2028.12.27
2	深圳信维智能	排污许可证	91440300MA5EJWWN13001Z	深圳市生态环境局宝安管理局	2025.3.31	2025.3.31-2030.3.30
3	伊高得	排污许可证	91440300727150835N001P	深圳市生态环境局宝安管理局	2025.12.22	2025.12.28-2026.12.27
4	江苏信维感应	固定污染源排污登记回执	91320413MA25FN9L9J001W	-	2024.12.9	2024.12.9-2029.12.8
5	聚永昶	固定污染源排污登记回执	91320509MA1WJ1TU4U001X	-	2022.6.29	2022.6.29-2027.6.28
6	江苏信维	固定污染源排污登记回执	91320413MA1MW6XE4J001X	-	2025.4.18	2025.4.18-2030.4.17
7	江苏信维智能	固定污染源排污登记回执	91320413MA1XX8668Y001W	-	2026.2.4	2026.2.4-2031.2.3
8	艾利门特	固定污染源排污登记回执	91440300088473020Q001Q	-	2025.12.1	2025.12.1-2030.11.30
9	维仕声学	固定污染源排污登记回执	91440300MA5GEGWR52001W	-	2025.9.29	2025.9.29-2030.9.28
10	信维通信（三厂）	固定污染源排污登记回执	914403007883357614003W	-	2025.9.29	2025.9.29-2030.9.28
11	信维通信	固定污染源排污登记回执	914403007883357614001W	-	2025.9.29	2025.9.29-2030.9.28
12	亚力盛	固定污染源排污登记回执	914403006189311064001Z	-	2025.8.25	2025.8.25-2030.8.24
13	维仕科技	固定污染源排污登记回执	91440300093924615R002X	-	2026.3.11	2026.3.19-2031.3.18
14	友维聚合	固定污染源排污登记回执	91310115MA1HBJTX0N001Z	-	2024.11.20	2024.11.20-2029.11.19

（八）境外经营

截至 2025 年 9 月 30 日，公司设立了 10 家境外控股子公司，分别为香港信维、香港亚力盛、香港声学、日本信维、瑞典信维、美国信维、韩国信维、越南信维、墨西哥信维、新加坡信维，具体情况如下：

序号	企业名称	成立日期	住所	股本	发行人持股情况
1	香港信维	2011.10.10	ROOM D, 10/F., TOWER,A BILLION CENTRE,1 WANGK WONG ROAD,KOWLOONBAY, KOWLOON,HONG KONG	1,500 万美元	信维通信持股 100%
2	香港亚力盛	2014.3.28	UNIT 1604, 16/F., NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG	10 万美元	亚力盛持股 100%
3	香港声学	2021.2.24	ROOM D, 10/F., TOWER,A BILLION CENTRE,1 WANGK WONG ROAD,KOWLOONBAY, KOWLOON,HONG KONG	1,000 万美元	维仕科技持股 100%
4	日本信维	2017.3.6	横滨市中区本町 1-4 号 Maison 横滨日本大通三楼 D 室	5,000 万日元	信维通信持股 100%
5	瑞典信维	2012.3.22	Kistagången 20B, 164 40 Kista, within the county of Stockholm, Sweden	55 万瑞典克朗	香港信维持股 100%
6	美国信维	2012.3.21	20400 Stevens Creek Blvd, Ste 100, Cupertino, CA 95014	185 万美元	香港信维持股 100%
7	韩国信维	2013.4.9	韩国京畿道水原市灵通区新园路 88,101 栋 801 号（新洞，第二数码帝国大厦 2 期）	199,999.50 万韩元	香港信维持股 100%
8	越南信维	2019.5.30	Lot CN 08, Binh Xuyen II Industrial Park, Binh Tuyen Commune, Phu Tho Province, Vietnam	2,300 万美元	香港信维持股 100%
9	墨西哥信维	2023.10.12	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico	17,170 万墨西哥比索	新加坡信维持股 99%；香港信维持股 1%
10	新加坡信维	2023.6.14	346C King George's Avenue, King George's Building, Singapore 208577	1,000 万新元	香港信维持股 100%

除此之外，公司在中国台湾地区及瑞士设立了分支机构，但均未实际开展业务经营。

根据公司聘请的境外律师出具的法律意见，公司境外子公司已取得所有为经营其业务而根据所适用境外法律的要求需取得的公司/商业许可、证照及批准，报告期内公司境外子公司的业务经营活动符合当地法律法规的规定。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司总体发展战略

公司作为全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，践行“本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当”的核心价值观，立足“技术驱动、全球布局、多元协同”的发展定位。

自 2006 年成立以来，公司一直专注于泛射频领域，从材料研究到技术设计，从制造工艺完善到产品良率提升，最大限度地扩充公司的产业链长度，进行垂直一体化整合。同时在产品布局方面，公司基于长期积累的射频相关技术和大客户平台，从天线业务起家，不断拓展到无线充电、EMI/EMC、射频连接器等泛射频领域。系统性地匹配客户更加多元化的需求，全方位地为客户提供一站式解决方案。

未来，公司将持续深化“材料—零部件—模组”的一站式研发创新能力，延伸产业链上游，提升产品核心竞争力；加快多业务领域布局，实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车+N”的跨越；强化全球化研发、生产与销售布局，提升全球市场渗透率与品牌影响力；通过持续的技术创新与高效的运营管理，实现业绩稳步增长。

（二）未来公司发展的具体计划

1、技术研发与储备

公司将持续加强对高分子材料、陶瓷材料、磁性材料、散热材料、功能复合材料等核心材料为代表的基础材料和相关基础技术的研究，进一步提升公司核心材料技术能力，进而提升公司在消费电子、商业卫星通信、智能汽车等领域的 5G/6G 天线、毫米波天线、LCP 模组、高性能精密连接器、无线充电、被动元件、UWB 模组等产品的竞争力。以为客户创造价值为最终目标，通过技术创新、产品领先提升公司竞争力。与此同时，公司积极开展基础材料、基础技术预研工作，在深耕通信及消费类电子行业的同时，已逐步进入商业卫星通信、智能汽车等行业，并前瞻性布局 6G、7G、数据中心、人工智能、人形机器人等新兴领域，为公司未来成长拓展空间。

2、业务拓展与布局

公司将在继续深耕消费电子业务的同时，加快第二增长曲线业务的拓展力度，提高公司的抗风险能力。继续巩固天线及模组、无线充电模组、EMI\EMC 器件等消费电子业务在客户端的优势地位，加大对新业务、新客户的拓展，提升消费电子业务的市场占有率。加快推进声学器件、高性能精密连接器、汽车互联产品、缝隙波导天线、UWB 模组、被动元件等新业务的客户覆盖，争取快速提升新业务的经营规模。

3、客户合作与管理运营

在客户合作方面，持续提升与客户在战略层面的合作，进一步加强对客户技术路径趋势和前沿技术的跟踪、预判，强化销售端—中央研究院—事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地。

在管理运营方面，公司将继续提升 EMT 集体领导决策机制的运作效率，通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，保障公司稳步健康的发展。

六、财务性投资情况

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”），对于财务性投资的要求如下：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷

款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之“7-1 类金融业务监管要求”，规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”“与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。”

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。根据企业会计准则及相关规定，最近一期末财务报表中可能涉及核算财务性投资（包括类金融业务）的财务报表科目分析如下：

单位：万元

项目	截至 2025 年 9 月 30 日金额	其中：财务性投资金额
货币资金	148,516.79	-
预付款项	1,946.85	-
其他应收款	5,726.85	-
其他流动资产	70,456.10	-
长期股权投资	54,558.05	-
其他非流动金融资产	5,926.41	3,026.41
投资性房地产	48,915.94	-
其他非流动资产	6,194.78	-

1、货币资金

截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金账面价值为 148,516.79 万元，主要为银行存款及保证金，不属于财务性投资。

2、预付款项

截至 2025 年 9 月 30 日，公司预付款项账面价值为 1,946.85 万元，主要为原材料采购预付款，不属于财务性投资。

3、其他应收款

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 5,726.85 万元，主要为押金、往来款、备用金、出口退税等，不属于财务性投资。

4、其他流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 70,456.10 万元，主要为待抵扣增值税进项税额、预付待摊销费用、模具摊销等，不属于财务性投资。

5、长期股权投资

截至 2025 年 9 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 54,558.05 万元，具体情况如下：

单位：万元/%

序号	被投资单位	成立日期	公司初始投资年份	2025 年 9 月末金额	2025 年 9 月末持股比例	是否属于财务性投资
1	中电科技德清华莹电子有限公司	1997-07-28	2017 年	28,646.92	16.4244	否

序号	被投资单位	成立日期	公司初始投资年份	2025年9月末金额	2025年9月末持股比例	是否属于财务性投资
2	信维电子科技（益阳）有限公司	2021-06-03	2021 年	23,832.28	[注]15.00	否
3	绵阳北斗电子有限公司	2005-08-03	2017 年	2,078.85	50.00	否
合计				54,558.05	/	/

注：发行人通过全资子公司信维通信（益阳）有限公司持有信维电子科技（益阳）有限公司 15%股权。

（1）中电科技德清华莹电子有限公司

根据公司射频前端业务的长期战略规划，公司于 2017 年入股德清华莹，有利于公司更好地把握 5G、物联网等通信领域的发展机遇，公司可结合已有的全球大客户平台优势，完善滤波器等射频前端业务的产业布局，进一步提升公司的综合竞争力和服务能力，符合公司的产业发展方向。公司对前述公司的投资不以获取投资收益为目的，不属于财务性投资。

（2）信维电子科技（益阳）有限公司

为进一步完善公司在被动元件领域的产业布局，2021 年，公司全资子公司信维通信（益阳）有限公司增资信维电子科技（益阳）有限公司，信维电子科技（益阳）有限公司主要业务为片式多层陶瓷电容，旨在推动高端 MLCC 项目，符合公司的产业发展方向。公司对前述公司的投资不以获取投资收益为目的，不属于财务性投资。

（3）绵阳北斗电子有限公司

绵阳北斗电子有限公司主要从事磁性材料的研发和生产，符合公司的产业发展方向。公司对前述公司的投资不以获取投资收益为目的，不属于财务性投资。

6、其他非流动金融资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 5,926.41 万元，具体情况如下：

单位：万元			
项目	截至 2025 年 9 月 30 日金额	其中：财务性投资金额	是否本次发行首次董事会前 6 个月内新增投资
四川易冲科技有限公司	1,853.75	1,853.75	否
China Renewable Energy Fund ,LP	852.66	852.66	否
湖南金康电路板有限公司	2,900.00	-	否

项目	截至 2025 年 9 月 30 日金额	其中：财务性投资金额	是否本次发行首次董事会前 6 个月内新增投资
常州市优瑞可商贸有限公司	120.00	120.00	否
深圳鑫钛科产业创新有限公司	200.00	200.00	否
合计	5,926.41	3,026.41	否

（1）四川易冲科技有限公司

四川易冲科技有限公司的主营业务范围为半导体集成电路芯片、计算机软硬件研发、智能电子产品研发、销售等，符合公司主营业务及战略发展方向，但由于发行人与该公司在报告期内没有直接的业务合作，因此基于谨慎性将其认定为财务性投资。

（2）China Renewable Energy Fund,LP

China Renewable Energy Fund,LP 系由北美核心客户发起的“清洁能源项目”。公司作为全球供应商清洁能源计划的重要参与者和中国清洁能源基金的首批投资者之一，积极履行保护地球环境的社会责任，虽然该投资的目的是拓展客户渠道，加强客户关系，但公司基于谨慎性将其认定为财务性投资。

（3）湖南金康电路板有限公司

湖南金康电路板有限公司为 FPC 软板厂商，公司对其投资有利于完善公司 FPC 软板供应链，具有协同效应，不属于财务性投资。

（4）常州市优瑞可商贸有限公司

常州市优瑞可商贸有限公司主营业务包括电子产品的销售，符合公司主营业务及战略发展方向，但由于发行人与该公司在报告期内没有直接的业务合作，因此基于谨慎性将其认定为财务性投资。

（5）深圳鑫钛科产业创新有限公司

深圳鑫钛科产业创新有限公司主营业务包括提供可持续发展战略规划及可持续金融服务，其在 ESG 及绿色金融服务方面具有丰富的经验，公司为关注及了解 ESG 行业的发展状况以及未来趋势，加快建设公司自身的 ESG 体系及能力，因此对其进行股权投资。但由于发行人与该公司在报告期内没有直接在主营业务方面开展合作，因此基于谨慎性将其认定为财务性投资。

7、投资性房地产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司投资性房地产账面价值为 48,915.94 万元，主要为公司江苏基地配套用房，不属于财务性投资。

8、其他非流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 6,194.78 万元，主要为预付设备、工程款，不属于财务性投资。

综上所述，最近一期末公司持有的财务性投资占归属于母公司净资产的比例为 0.39%，不超过 30%，因此不存在持有金额较大的财务性投资的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规的规定。

（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司新投入和拟投入的财务性投资（含类金融业务）情况

自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施的投资类金融业务、非金融企业投资金融业务、与公司主营业务无关的股权投资、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、购买收益波动大且风险较高的金融产品等财务性投资。

七、合法合规及诉讼、仲裁情况

（一）发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关主体的合法合规情况

截至募集说明书出具日，发行人现任董事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责；发行人、现任董事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

（二）诉讼、仲裁情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司不存在尚未了结的重大诉讼、

仲裁事项。

八、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况

报告期内，发行人收到深交所下发的《关于对深圳市信维通信股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2025】第 817 号），公司已同年审会计师就问询事项进行了逐项落实，完成了 2024 年年报问询函的回复。除上述问询函外，公司在报告期内不存在其他深圳证券交易所下达年度报告问询的情形，不存在年报多次问询事项。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行股票的背景

1、国家政策背景

我国高度重视新一代信息技术和半导体等战略性新兴产业发展，出台多项针对性政策形成协同发力格局，为产业高质量发展保驾护航。国家始终以科技创新与产业升级为核心，坚持制造业创新驱动、智能转型，推进核心零部件国产化与产业链优化，为企业研发及产业升级创造了良好的政策与市场环境，从而为本次发行募投项目提供了坚实的支撑。

在商业卫星通信领域，关键核心技术攻关突破，产业从技术验证阶段迈向商业化运营阶段，基础元器件、芯片、终端设备供给具有了明确的商业化前景。在射频天线器件领域，呈现智能终端与汽车电子双轮驱动格局，一方面新一代信息技术政策聚焦 5G/6G 关键器件攻关，鼓励新型电子元器件制造与全产业链数字化转型，契合消费电子需求；另一方面，半导体与智能汽车政策协同，车规级核心部件国产化，推动智能网联新能源汽车技术应用，为车载场景拓展提供动力。在芯片导热散热领域，国家政策将芯片热管理技术纳入重点范畴，支持液态金属等新型导热材料产业化，同时智能汽车发展拉动高性能车规级散热解决方案需求，从材料创新到应用场景全方位支撑项目发展。

2、行业市场背景

在新一代信息技术快速迭代与新兴应用场景持续拓展的推动下，商业卫星通信、射频器件、芯片导热散热器件三大赛道市场需求持续提升，行业发展前景广阔，同时核心部件国产化需求日益迫切，为公司本次再融资募投项目提供了广阔的市场空间。

在商业卫星通信领域，低轨卫星互联网星座建设进入实施阶段，从而将带动地面终端设备需求增长，其中高频高速连接器、阵列天线等关键核心部件技术壁垒较高，市场供给相对紧张，具备核心技术优势的供应商将持续受益。在射频器件和组件领域，通信技术向更高频段升级，各类终端设备对射频器件及组件的性

能、集成度要求不断提高，智能终端、汽车等下游领域的需求持续释放，从而带动射频器件及组件市场持续扩容，高阶智能驾驶渗透率、网联化配置渗透率持续提升，为 5G/6G 智能终端 AiP 封装天线、毫米波雷达天线及组件等射频器件提供了广阔需求空间。在芯片导热散热领域，芯片功率密度不断提升，对高效导热散热解决方案的需求日益迫切，新型高效导热散热器件市场需求持续扩大，目前全球高端芯片导热散热器件市场仍由海外企业主导，国产自主可控需求迫切。

（二）本次发行股票的目的

1、持续加大生产投入，巩固“第一增长曲线”领先优势

公司作为全球射频天线领域的领先企业，依托“材料—零部件—模组”一站式解决方案能力，持续加大研发投入，不断夯实并强化在 5G/6G、卫星通信、智能汽车等新兴应用场景的市场竞争力。其中，LCP 天线通过自主研发 LCP 薄膜、柔性覆铜板及压合工艺，核心材料与技术全自主可控，实现了高频传输、弯折适应性与极致轻薄化的深度融合；透明天线依托透明导电薄膜技术创新与微纳精密加工工艺升级，达成高透光率、优异射频性能与环境可靠性的全域平衡，兼顾功能实现与场景适配；缝隙波导天线凭借创新的非平面波导辐射面与多缝隙结构设计，实现波束宽度扩展、低损耗与高功率容量的高效协同，大幅提升高等级自动驾驶场景下的探测精度与运行安全性，精准匹配智能汽车核心应用需求。结合自主研发的先进高频高速连接器产品，公司可向客户提供从材料到模组的全链路高频高速一站式解决方案，实现核心产品的协同赋能与整体价值升级。

凭借移动终端天线领域深耕积累的产品实力、行业地位、市场份额等多方面优势，公司于 2024 年获评工信部“制造业单项冠军企业”荣誉称号。

随着业务规模稳步扩大，现有产能已难以匹配下游客户持续增长订单需求的情况已经成为了制约公司发展的瓶颈。因此，本次发行将助力公司有效突破产能限制，保障对高端产品与前沿技术的持续投入，通过规模化生产进一步摊薄成本、提升产品性价比，从而巩固并夯实公司在智能终端射频天线“第一增长曲线”上的领先优势。

2、推动有竞争力的新产品线落地，驱动“第二增长曲线”快速成长

在巩固夯实“第一增长曲线”领先优势的同时，公司正加速开辟以新产品、

新技术为核心的“第二增长曲线”，重点将商业卫星通信、新型射频器件及芯片导热散热领域已取得的技术突破转化为规模化量产能力，构筑新的业绩增长引擎。

具体而言，在商业卫星通信领域，公司将在已实现批量供货的高频高速连接器基础上，进一步拓展阵列天线及模组等新产品；在射频器件领域，公司以毫米波雷达天线组件为发力点，深入布局智能汽车自动驾驶赛道，把握智能网联汽车自动驾驶技术升级带来的历史发展机遇；在芯片导热散热领域，公司将由器件供应商向解决方案提供商升级，通过拓展 TIM 材料业务，提供“TIM+散热器件”组合方案以增强客户粘性。因此，本次发行将有力推动公司以上领域业务快速发展，填补国内相关领域空白、拓展新的应用场景与客户群体，从而为公司构建长期可持续的增长动力，有力驱动“第二增长曲线”快速成长。

3、优化资本结构

公司本次发行完成后，可以进一步优化资本结构，增大总资产及净资产规模，减轻财务风险，增强公司综合竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，为公司未来融资及长期可持续发展奠定坚实基础。

二、发行对象及与发行人的关系

（一）发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的

发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（二）发行对象与公司的关系

截至本募集说明书出具日，本次向特定对象发行股票尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以同一价格认购本次向特定对象发行股票。

（四）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P_1 。

最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过290,270,591股（含本数），最终发行数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深交所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票，亦应遵守上述限售期安

排。上述限售期届满后，发行对象减持还需根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

（七）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入
1	商业卫星通信器件及组件项目	356,316.21	285,000.00
2	射频器件及组件项目	285,270.72	215,000.00
3	芯片导热散热器件及组件项目	116,941.91	100,000.00
合计		758,528.84	600,000.00

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次发行股票前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（十）本次发行股票决议的有效期限

本次发行股票决议经公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具日，本次向特定对象发行股票尚未确定具体发行对

象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至 2025 年 9 月 30 日，公司股东彭浩先生直接持有公司 188,503,533 股股份，持股比例为 19.48%，为公司实际控制人。公司股权结构较为分散，除实际控制人外，公司不存在单一持股超过 5% 的股东。按照本次发行规模上限测算，本次发行完成后彭浩先生持股比例不低于 14.99%，仍为公司实际控制人。因此本次发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

本次发行股票预计募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入
1	商业卫星通信器件及组件项目	356,316.21	285,000.00
2	射频器件及组件项目	285,270.72	215,000.00
3	芯片导热散热器件及组件项目	116,941.91	100,000.00
合计		758,528.84	600,000.00

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）商业卫星通信器件及组件项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

2、项目投资计划

本项目预计总投资 356,316.21 万元，拟使用募集资金 285,000.00 万元，项目投资构成具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	总投资	拟使用募集资金	是否属于资本性投入
1	建设投资	239,588.60	230,759.55	-
1.1	工程费用	228,179.62	219,771.00	是
1.1.1	建筑工程费	17,769.62	9,361.00	是
1.1.2	设备购置费	210,410.00	210,410.00	是
1.2	基本预备费用	11,408.98	10,988.55	否
2	铺底流动资金	116,727.61	54,240.45	否

序号	名称	总投资	拟使用募集资金	是否属于资本性投入
	合计	356,316.21	285,000.00	-

本项目投资测算根据项目实际需求确定，测算具备合理性。

3、项目效益测算

(1) 效益测算假设条件

本次募集资金能够及时到位，募集资金投资项目能够顺利如期完成；公司经营管理层和核心技术人员未发生重大变化；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；公司所遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化；公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变；原材料价格供应和价格处于正常变动范围内；无其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

(2) 测算过程

①收入测算

本项目主要生产高频高速线缆及连接器、阵列天线及天线模组，各项产品销售价格主要以相同或类似产品历史销售价格、本次募投项目产品生产成本和合理利润空间为基础，结合未来市场行情预估进行测算。基于谨慎性原则，对前述产品自第三年至第五年分别预测 4%、4%和 3%的价格年降幅，达产年（即第六年）之后价格趋于稳定。

本次项目分三期投资建设，分别于第一年、第二年及第三年投入。项目自第二年开始投产，第六年达产比例爬坡至 100%。

②成本测算

直接材料：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接燃料和动力：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接人工：人工成本根据需要使用的人员数量，结合同类岗位员工工资水平进行测算；

制造费用：固定资产折旧、无形资产摊销等综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算，其他制造费用参考公司历史情况并合理考虑未来情况进行估算。

③期间费用

期间费用率参考公司历史期间费用率，合理考虑未来情况进行测算。

④税费测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

（3）测算结果

经测算，本项目达产年，预计年营业收入为 949,913.40 万元，年税后利润为 96,942.17 万元，税后利润率为 10.21%，内部收益率 21.11%（税后），总投资回收期 7.56 年（税后），项目预计经济效益较好。

报告期内，发行人销售净利率分别为 7.65%、6.95%、7.49%和 7.48%，本项目利润率较高主要系本项目聚焦高附加值产品，产品技术壁垒与盈利空间显著高于公司部分传统业务，以及项目达产后产能规模效应凸显，单位生产成本随产能利用率提升而摊薄产生规模优势所致，具有合理性。

4、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书出具日，本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证和常州市生态环境局出具的环评批复，本项目不涉及新增土地，不涉及用地审批。

5、募集资金的预计使用进度，是否包含董事会前投入的资金

本项目建设期为 36 个月，预计总投资为 356,316.21 万元，该项目拟使用募集资金 285,000.00 万元。在本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。

本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。

（二）射频器件及组件项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

2、项目投资计划

本项目预计总投资 285,270.72 万元，拟使用募集资金 215,000.00 万元，项目投资构成具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	总投资	拟使用募集资金	是否属于资本性投入
1	建设投资	203,902.75	173,487.22	-
1.1	工程费用	194,193.10	165,225.92	是
1.1.1	建筑工程费	62,250.39	33,283.21	是
1.1.2	设备购置费	131,942.71	131,942.71	是
1.2	基本预备费用	9,709.65	8,261.30	否
2	铺底流动资金	81,367.97	41,512.78	否
合计		285,270.72	215,000.00	-

本项目投资测算根据项目实际需求确定，测算具备合理性。

3、项目效益测算

（1）效益测算假设条件

本次募集资金能够及时到位，募集资金投资项目能够顺利如期完成；公司经营管理层和核心技术人员未发生重大变化；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；公司所遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化；公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变；原材料价格供应和价格处于正常变动范围内；无其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）测算过程

①收入测算

本项目主要生产 AI 智能终端天线及模组、LCP 传输线、天线及模组等产品，各项产品销售价格主要以相同或类似产品历史销售价格、本次募投项目产品生产成本和合理利润空间为基础，结合未来市场行情预估进行测算。基于谨慎性原则，对前述产品自第三年至第五年分别预测 4%、4%和 3%的价格年降幅，达产年（即第六年）之后价格趋于稳定。

本次项目分三期投资建设，分别于第一年、第二年及第三年投入。项目自第二年开始投产，第六年达产比例爬坡至 100%。

②成本测算

直接材料：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接燃料和动力：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接人工：人工成本根据需要使用的人员数量，结合同类岗位员工工资水平进行测算；

制造费用：固定资产折旧、无形资产摊销等综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算，其他制造费用参考公司历史情况并合理考虑未来情况进行估算。

③期间费用

期间费用率参考公司历史期间费用率，合理考虑未来情况进行测算。

④税费测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

（3）测算结果

经测算，本项目达产年，预计年营业收入为 706,669.06 万元，年税后利润为 91,990.00 万元，税后利润率为 13.02%，内部收益率 24.99%（税后），总投资回收期 6.65 年（税后），项目预计经济效益较好。

报告期内，发行人销售净利率分别为 7.65%、6.95%、7.49%和 7.48%，本项目利润率较高主要系本项目聚焦高附加值产品，产品技术壁垒与盈利空间显著高

于公司部分传统业务，以及项目达产后产能规模效应凸显，单位生产成本随产能利用率提升而摊薄产生规模优势所致，具有合理性。

4、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书出具日，本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证和常州市生态环境局出具的环评批复，本项目不涉及新增土地，不涉及用地审批。

5、募集资金的预计使用进度，是否包含董事会前投入的资金

本项目建设期为 36 个月，预计总投资为 285,270.72 万元，该项目拟使用募集资金 215,000.00 万元。在本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。

本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。

（三）芯片导热散热器件及组件项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

2、项目投资计划

本项目预计总投资 116,941.91 万元，拟使用募集资金 100,000.00 万元，项目投资构成具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	总投资	拟使用募集资金	是否属于资本性投入
1	建设投资	85,023.42	77,086.80	-
1.1	工程费用	80,974.69	73,416.00	是
1.1.1	建筑工程费	8,114.36	3,818.00	是
1.1.2	设备购置费	72,860.33	69,598.00	是
1.2	基本预备费用	4,048.73	3,670.80	否
2	铺底流动资金	31,918.49	22,913.20	否

序号	名称	总投资	拟使用募集资金	是否属于资本性投入
	合计	116,941.91	100,000.00	-

本项目投资测算根据项目实际需求确定，测算具备合理性。

3、项目效益测算

(1) 效益测算假设条件

本次募集资金能够及时到位，募集资金投资项目能够顺利如期完成；公司经营管理层和核心技术人员未发生重大变化；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；公司所遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化；公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变；原材料价格供应和价格处于正常变动范围内；无其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

(2) 测算过程

①收入测算

本项目主要生产芯片导热 TIM 产品、芯片封装散热片等产品，各项产品销售价格主要以相同或类似产品历史销售价格、本次募投项目产品生产成本和合理利润空间为基础，结合未来市场行情预估进行测算。基于谨慎性原则，对芯片封装散热片自第三年至第五年分别预测 4%、4%和 3%的价格年降幅，达产年（即第六年）之后价格趋于稳定。

本次项目分三期投资建设，分别于第一年、第二年及第三年投入。项目自第二年开始投产，第六年达产比例爬坡至 100%。

②成本测算

直接材料：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接燃料和动力：参考公司相应产品的工艺消耗定额，合理考虑未来情况进行测算；

直接人工：人工成本根据需要使用的人员数量，结合同类岗位员工工资水平进行测算；

制造费用：固定资产折旧、无形资产摊销等综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算，其他制造费用参考公司历史情况并合理考虑未来情况进行估算。

③期间费用

期间费用率参考公司历史期间费用率，合理考虑未来情况进行测算。

④税费测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

（3）测算结果

经测算，本项目达产年，预计年营业收入为 310,478.43 万元，年税后利润为 47,437.79 万元，税后利润率为 15.28%，内部收益率 31.44%（税后），总投资回收期 6.45 年（税后），项目预计经济效益较好。

报告期内，发行人销售净利率分别为 7.65%、6.95%、7.49%和 7.48%，本项目利润率较高主要系本项目聚焦高附加值产品，产品技术壁垒与盈利空间显著高于公司部分传统业务，以及项目达产后产能规模效应凸显，单位生产成本随产能利用率提升而摊薄产生规模优势所致，具有合理性。

4、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书出具日，本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证和常州市生态环境局出具的环评批复，本项目不涉及新增土地，不涉及用地审批。

5、募集资金的预计使用进度，是否包含董事会前投入的资金

本项目建设期为 36 个月，预计总投资为 116,941.91 万元，该项目拟使用募集资金 100,000.00 万元。在本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法律法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。

本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。

三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目实施的必要性

1、把握战略机遇，巩固技术领先地位

当前，信息技术领域各类前沿技术持续发展与交叉融合，为高端电子元器件行业带来了相应的市场空间与发展机会。公司所关注的商业卫星通信、射频器件及芯片导热散热三个方向，是支持相关产业发展的基础环节，市场需求呈现持续增长态势。

在此背景下，公司作为相关领域的参与企业，有必要通过本次募投项目缓解产能约束，将技术积累转化为规模生产能力。目前，现有产能已逐渐难以完全满足下游客户订单的增长，成为公司进一步拓展市场、维持竞争力的现实约束。

因此，本项目的建设是公司顺应产业发展趋势、将技术优势转化为市场优势的战略举措，有助于巩固在传统优势领域的领先地位，为长期高质量发展注入持续动力。

2、深化技术产业化，构建综合竞争优势

公司的核心竞争力源于持续的研发投入和“材料—零部件—模组”的一站式技术创新能力。本项目是公司推动技术成果产业化的关键载体。通过对先进材料、技术、工艺等工程能力的扩充与升级，实现高附加值产品的批量生产，优化营收结构，提升高端产品的收入占比，增强整体盈利能力。

同时，规模化生产将明显提升公司的生产效率。一方面，能够摊薄单位生产成本，提升产品性价比，在国产化替代浪潮中增强市场竞争力；另一方面，有利于公司为客户提供更全面、定制化的解决方案，从而深化客户合作，构建坚实的技术与客户壁垒，强化在产业链中的核心地位。

（二）项目实施的可行性

1、政策多维赋能，产业方向明确，营造良好发展环境

国家及地方层面围绕新一代信息技术、商业航天、智能汽车、高端元器件等领域密集出台了一系列产业政策，为本项目的实施提供了明确的战略指引和有利的外部环境。宏观层面，《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计强调要加快

建设新型基础设施，推动产业智能化、高端化升级，与公司重点发展的卫星通信、射频及散热技术高度契合。产业专项层面，工信部等部门针对卫星通信、5G/6G、智能网联汽车等出台了具体的发展规划和指导意见，明确提出要突破关键核心技术，完善产业链供应链，为本项目产品提供了清晰的应用场景和市场入口。多层次的政策支持体系，从技术研发、产能建设到市场应用形成了全方位赋能，确保了项目方向与国家战略同频共振，为成功实施奠定了坚实的政策基础。

2、前沿技术布局，工艺经验成熟，保障量产落地

（1）商业卫星通信器件及组件项目

公司凭借多年在射频通信领域的深耕，已构建了成熟的质量管控体系和核心技术优势。在阵列天线及模组领域，通过多种材料和技术的创新集成设计，实现了产品宽频化与轻量化；在高频高速连接器领域，通过定制化设计与多层级防水密封技术，产品可在宽温域及复杂环境下稳定工作。公司成熟的核心技术方案为项目大规模量产提供了可靠的工艺和技术保障。

（2）射频器件及组件项目

公司在射频技术领域已形成多维度、领先的技术储备。LCP 天线方面，公司拥有自主研发的 LCP 薄膜及柔性覆铜板规模化量产能力，采用合金浆料真空塞孔、多层高温一次压合的独有先进工艺，性能稳定；透明天线方面，公司通过 UltraMesh 工艺在透明基材上构建微米级金属网格，产品光学与电学性能优异；毫米波雷达天线组件方面，公司掌握缝隙波导天线等核心器件的生产工艺，并拥有精密模具注塑及全流程自动化组装测试核心技术。公司已构建全流程标准化工艺闭环，核心工序自动化，并通过了消费级、工业级、汽车级多场景质量体系认证，技术成熟度与产品稳定性已获市场验证，具备大规模量产的条件。

（3）芯片导热散热器件项目

公司在芯片封装散热方面有一站式解决方案，聚焦高导热热界面 TIM1 材料与芯片封装散热片两大核心产品。在 TIM1 材料方面，公司通过自研掌握了基于液态金属和高分子材料的先进配方技术，该材料具备高热导率、优异的界面兼容性与极端工况适应性，能够精准匹配先进封装及算力芯片等高端应用场景的散热需求。在芯片封装散热片方面，公司掌握了核心的精密微加工与半导体表面处理

技术，在保障性能与品质前提下兼具产能与成本优势，满足多场景下的可靠性要求。经过数年的研发与生产的积累，公司已建立起完善的工艺参数数据库，生产管理体系与供应链渠道完备，为后续快速量产与品质一致性提供了坚实保障。

3、市场需求旺盛，客户资源优质，确保产能有效消化

在高度关注且充分理解客户真正需求的基础上，公司已经搭建了优质的全球大客户平台，并持续与客户保持良好的合作关系，把客户满意落到实处，凭借稳定的品质、及时的交付、有竞争力的产品，获得了客户的高度认可，凭借着基础材料、基础技术的持续投入，公司技术能力受到客户的重视，公司定期与全球大客户展开技术交流，增加了大客户的黏性与新技术的洞察力。

在商业卫星地面终端领域，公司已经是北美商业卫星客户的长期供应商，产品已获批量采用；在射频器件和组件领域，公司客户覆盖全球多家知名科技企业及主流主机厂，与核心客户建立了深度合作关系；在芯片导热散热器器件领域，公司是中国内地能为北美大客户批量供应芯片导热器件的企业，产品技术创新、性能指标及可靠性获市场充分认可。

4、完善的管理制度和人才储备为募投项目实施保驾护航

公司管理层根据业务发展及客户的需求对组织架构进行优化，完善内部管理制度和流程，提升决策效率、生产组织、交付质量，强化多任务处理能力、综合工程实现能力、柔性制造能力以及供应链管理能力和能力，逐渐搭建了平台型大事业部制组织架构，目前已与客户形成高效且全面的对接。

另外，人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，公司积极引进技术及管理人才，优化人才结构，加强人才梯队建设，继续完善绩效考核评价体系及员工长效激励机制，目前已经在国内、北美、日本、韩国和欧洲等多地设立了研发中心，组建了拥有基础材料、基础技术、射频通信等领域深度研究经验和国际化视野的人才团队。

（三）本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的说明

根据《证券期货法律适用意见第18号》，本次发行符合理性融资，合理确定融资规模相关规定，具体情况如下：

(1) 上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

本次拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终以深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册为准。

(2) 上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

公司已就本次发行相关事项履行了董事会决策程序，且董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月。

(3) 实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

本次发行属于向特定对象发行，不属于前述情形。

(4) 上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”。

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前总股本的 30%；本次向特定对象发行股票董事会决议日距离前次募集资金到位超过 18 个月；本次发行募集资金不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用之后将全部用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，募集资金投资项目与发行人主营业务密切相关，有利于发行人抓住行业发展趋势，提升规模优势，进一步巩固公司的市场竞争地位，推动公司高质量发展。

综上所述，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》“四、关于第四十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”的要求。

四、本次募投项目其他相关情况

（一）本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系

1、本次募投项目与公司既有业务的关系

公司主营业务覆盖天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI/EMC 器件、高精度连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等，客户涵盖全球知名科技企业，应用领域包括消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等。本次发行募集资金投向“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，均围绕公司现有主营业务展开，具体而言，在商业卫星通信领域，公司将在已实现批量供货的高频高速连接器基础上，进一步拓展阵列天线及模组等新产品；在射频器件领域，公司以毫米波雷达天线组件为发力点，深入布局智能汽车自动驾驶赛道，把握智能网联汽车自动驾驶技术升级带来的历史发展机遇；在芯片导热散热领域，公司将由器件供应商向解决方案提供商升级，通过拓展 TIM 材料业务，提供“TIM+散热器件”组合方案以增强客户粘性。

本次募投项目是公司将已拥有技术成果通过规模化生产实现其商业价值，推动行业迭代发展而做出的重要布局，有利于适应行业需求，巩固公司的市场地位，促进公司可持续发展。

2、本次募投项目与前次募投项目的关系

最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

2015 年，公司以支付现金及发行股份的方式收购深圳亚力盛连接器有限公司并募集配套资金，两次募投项目在投资形式、项目建设内容、涉及业务、建设目的等方面均存在显著差异，但均围绕公司现有主营业务展开。

（二）本次募集资金投资项目未用于拓展新业务、新产品

本次募集资金投资项目均属于与公司既有业务相关的项目，不属于拓展新业务、新产品。

（三）因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响

本次募集资金投资项目建成后，固定资产、无形资产将大幅增加，公司每年将新增一定规模的折旧摊销费。根据初步测算，本次募投项目完全达产后首年将新增折旧摊销金额 48,237.80 万元。

报告期内，公司营业收入分别为 858,991.66 万元、754,764.57 万元、874,361.06 万元和 646,237.27 万元。本次募投项目完全达产后，首年将新增 48,237.80 万元折旧摊销费，占 2022 年至 2024 年公司年平均营业收入的 5.82%。考虑到项目完全达产后首年预计可新增收入 1,967,060.89 万元，该部分新增折旧摊销金额占预计新增收入的比例为 2.45%，占比较低。

（四）发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

发行人通过持续的研发投入和技术创新，构建了从材料研发到产品设计、精密制造的一站式服务能力，形成了较强的技术护城河。目前，公司已与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、商业航天及汽车电子等领域，具备较强的市场竞争力和品牌影响力，为募投项目的实施提供了有力保障。

本次募集资金项目总投资金额为 758,528.84 万元，本次发行股票预计募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

（五）本次募集资金是否存在用于补充流动资金的情形

发行人本次募投项目不存在补充流动资金项目，拟将募集资金 141,587.08 万元用于募投项目中的非资本性支出，其中项目基本预备费 22,920.65 万元、项目铺底流动资金 118,666.43 万元，占本次发行募集资金总额的 23.60%，该等非资本性支出规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规，具有可行性。

（六）本次募投项目符合国家产业政策的要求和板块定位

本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类,发行人所属行业为“制造业”(分类代码为C)下属的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,细分行业为“C392 通信设备制造”。从细分行业来看,发行人主营业务为通信设备制造业中的天线及射频元器件的研发、生产和销售。

本次募集资金将投向“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”,均围绕公司现有主营业务展开,与公司实际需求匹配。公司所属的通信设备制造业不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录》中规定的限制类、淘汰类行业,不涉及高耗能高排放行业,本次募投资金投向符合国家产业政策要求。

五、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司始终专注于射频主业,不断深耕细作,通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展,实现了公司的可持续发展。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目实施完成后,公司能够进一步用以提升技术水平及生产效率,巩固和提高公司的行业地位,并将进一步提升公司的核心竞争力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,公司的财务状况将得到进一步改善,公司总资产及净资产规模将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益,本次发行可能导致公司短期内净资产收益率下降,每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产,公司的盈利能力将得到明显提高。本次发行完成后,上市公司将获得大额募集资金的现金流入,筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募集资金拟投资项目的逐步建成和投产,公司主营业务收入规模将有大幅增加,盈利水平将得以提高。

六、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述,本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关法律法规以及公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使

用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响情况

（一）本次发行对公司业务、资产和业务结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后拟将全部用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有业务及资产的整合，因此本次发行不会对公司的业务结构产生重大影响。

（二）公司章程调整

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将根据发行结果修改公司章程所记载的注册资本等相关条款，并办理工商变更登记。

（三）股东结构变化

本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 290,270,591 股（含本数），最终发行数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司股东彭浩先生直接持有公司 188,503,533 股股份，持股比例为 19.48%，为公司实际控制人。公司股权结构较为分散，除实际控制人外，公司不存在单一持股超过 5% 的股东。按照本次发行规模上限测算，本次发行完成后彭浩先生持股比例不低于 14.99%，仍为公司实际控制人。

因此本次向特定对象发行不会导致公司股权分布出现不具备上市条件的情况，亦不会出现控股股东和实际控制人发生变化的情况。

（四）对高管人员结构的影响

公司不存在因本次发行对公司高管人员进行调整的计划，公司高管人员结构不会发生重大变动。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。

本次发行后，由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司的盈利能力将得到明显提高。

本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募集资金拟投资项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将有大幅增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行前，公司负债结构符合所在行业的特点，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率（合并口径）为 43.43%，本次发行后，公司的资产负债率将有所下降，资产结构有

所优化，偿债能力有所提高。本次发行不会导致公司负债增加，随着公司经营活动的进一步开展，公司的资产负债水平和负债结构会更加合理。

第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况

一、最近五年内募集资金运用基本情况

最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

二、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度且已使用完毕，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

三、公司历次融资募集资金情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1401号）核准，公司向社公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额529,272,500.00元，扣除承销费和保荐费33,956,350.00元后的募集资金为人民币495,316,150.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用5,611,647.01元后，公司本次募集资金净额为人民币489,704,502.99元，上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市信维通信股份有限

公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

2、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 48,970.45 万元，根据《深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划，公司计划投资终端天线技术改造项目、研发测试中心建设项目两个项目，本次超募资金总额为 26,722.45 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金
承诺投资项目		22,248.00	22,248.00
1	终端天线技术改造项目	18,998.00	8,659.91
2	研发测试中心建设项目	3,250.00	2,897.80
3	结余募集资金永久补充公司流动资金	-	10,690.29
超募资金投向		26,722.45	26,722.45
1	收购英资莱尔德无线通信技术（北京）有限公司	17,303.00	17,303.00
2	永久补充流动资金	9,419.45	9,419.45
合计		48,970.45	48,970.45

公司永久补充流动资金和超募资金用于收购英资莱尔德无线通信技术（北京）有限公司均履行了相应的必要审议程序，公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

（二）支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、基本情况

2015 年 6 月 26 日，中国证监会出具了《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向深圳市亚力盛投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1416 号），核准公司向深圳市亚力盛投资有限公司发行 39,267,015 股股份、向深圳德威首创投资企业（有限合伙）发行 2,617,801 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 9,424,083 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2015 年 7 月 14 日止，公司募集发行股份购买资产的配套资金的非公开

发行股票 9,424,083 股，募集配套资金总额为人民币 90,000,000.00 元。扣除保荐、承销费 8,000,000.00 元后的募集资金为人民币 82,000,000.00 元；另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 758,709.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 81,241,291.00 元，上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市信维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

2、募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金
承诺投资项目		8,200.00	8,200.00
1	收购深圳亚力盛连接器有限公司	8,200.00	8,026.00
2	永久补充流动资金	-	174.00

公司永久补充流动资金履行了相应的必要审议程序，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

综上，公司前次募集资金到账已满五个会计年度，前次募集资金已于 2016 年末使用完毕。公司历次募集资金使用规范，超募资金使用以及将结余资金用于补充流动资金等情形均已履行相应的审批手续，前述募集资金使用情形对于本次发行无实质影响。

第六节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应认真考虑下述各项风险因素：

一、行业风险

（一）行业下游需求波动风险

发行人主营业务与消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等下游应用市场高度关联，而上述下游应用领域的发展与全球宏观经济走势、消费者可支配收入水平及消费意愿密切相关。当全球或主要经济体出现经济下行、通胀高企等情况时，消费者会延迟智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等终端产品的更换周期，导致下游终端厂商缩减生产计划及采购规模，进而传导至包括射频元器件制造在内的上游行业，造成公司产品需求下滑、订单减少。此外，公司新兴业务所处的卫星通信、智能汽车领域虽处于高增长阶段，但仍可能受宏观经济波动影响，出现市场需求不及预期的风险。同时，随着 5G 建设进入中后期，6G 商用尚未进入规模化阶段，行业需求存在阶段性波动风险。

（二）新兴业务发展不及预期风险

为有效应对下游消费电子行业需求波动、市场竞争加剧及行业调整带来的经营不确定性风险，增强公司抗风险能力，实现可持续发展，公司正积极推进业务结构多元化转型，以消费电子领域业务为核心基本盘，以商业卫星通信、智能汽车领域为核心增长引擎，同时依托公司在泛射频领域的技术积累，积极孵化新技术及产品，在数据中心、人工智能、低空飞行、人形机器人等前沿应用领域探索更多成长机会，打造新的增长曲线。但新兴业务领域具有技术壁垒高、研发周期长、投入资金大、市场培育周期长等特点，存在发展不及预期的风险。

二、经营风险

（一）市场竞争风险

射频元器件行业具备创新周期短、产品迭代快的特征，下游需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入，通过持续研发来保证产品在技术上的领先性。但与此同时，公司的主要竞争对手也在

资金、人员、技术上具备匹配度，随着公司主要产品的不断迭代和类别的不断延伸，公司将面临更加激烈的市场竞争。

公司在主要产品生产规模和工艺技术方面具有较强的市场竞争能力，显现出良好的发展前景，但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

（二）原材料价格、人工成本上涨风险

公司主要成本为原材料、制造费用和人工。2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司综合毛利率分别为 21.81%、22.07%、20.82%和 21.53%，表现出较强的盈利能力和成本上涨的消化能力。但是，若原材料价格、人工成本持续上涨，公司产品成本上升仍将对公司利润造成不利影响。

（三）外贸环境恶化的风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司境外销售收入占营业收入的比重分别为 78.22%、81.33%、73.22%和 65.42%，比重较高。公司已与主要海外客户建立了良好、稳定的合作关系，但公司产品出口仍然受到电子产品及其零部件进出口政策变化等多方面外贸环境的制约，若国际市场的政治稳定性、外贸政策出现重大变化，将可能对公司生产经营产生重大影响，直接或间接影响公司的出口业务。

（四）业务快速扩张的管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，公司员工人数相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

（五）核心技术人员流失的风险

射频元器件行业高端技术研发及生产人才需求加剧、竞争激烈，虽然发行人在天线及模组、高精密连接器等领域处于领先地位，如果公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心技术人员的流失或核心技术的泄密，使公司在技术

竞争中处于不利地位，影响公司长远发展。

三、财务风险

（一）募集资金投资项目新增产能消化及预计效益实现风险

公司本次募集资金投资于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”。上述项目的实施有助于公司落实发展战略、扩大经营规模和提升盈利水平。虽然公司对上述项目的市场前景以及可行性进行了充分的论证，但竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、行业技术的变革、宏观经济形势的变化以及营销渠道的开拓等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响，特别是卫星发射能力、网络服务的连续性与稳定性，以及终端成本、资费水平与规模化用户培育周期等商业卫星通信行业发展的关键要素均存在较大的不确定性。

现阶段，公司第二增长曲线业务虽然在前期投入下取得较明显进展，但整体业务规模仍处于发展早期，其市场根基有待进一步夯实。若上述因素对公司实施募投项目产生不利影响，将可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法消化以及预计效益不能实现，从而对公司经营业绩产生一定不利影响。

（二）汇率波动的风险

公司主要经营地位于中国境内，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司境外销售收入占营业收入的比重分别为 78.22%、81.33%、73.22%和 65.42%，公司向海外客户的销售收入主要以外币结算，因此存在较大的美元应收账款余额。随着公司的海外业务不断拓展，若人民币汇率发生较大幅度的波动，而公司如不能采取有效的应对措施，可能会导致公司开展的海外业务在外汇结算过程中面临汇率风险，进而在一定程度上影响公司盈利水平。

为提高公司应对外汇波动风险的能力，公司开展了外汇套期保值业务，但同时也存在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致造成的汇兑损失与汇率在未来发生波动时与外汇套期保值合约偏差较大时造成汇兑损失等风险。

（三）应收账款规模较大的风险

2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 9 月 30 日，公司应收账款账面价值分别为 243,809.31 万元、208,363.02 万元、226,573.71 万元和 233,898.24 万元，占同期资产的比例分别为 19.96%、16.19%、16.94%和 17.23%，公司应收账款规模较大。虽然公司的主要债务人信用状况良好，但是如果主要债务人的财务经营状况发生恶化，则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备提取比例不足的风险，从而将会影响公司的资产质量及盈利水平。

（四）主要客户集中风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为 52.44%、59.88%、50.83%和 48.60%，客户集中度较高。若公司主要客户的生产经营情况发生不利变化或产品结构调整，导致其对公司产品的需求减少，公司的生产经营将受到不利影响，致使公司面临业绩下滑的风险。

（五）商誉减值的风险

截至 2025 年 9 月 30 日，公司商誉账面原值为 100,244.54 万元，主要系收购深圳亚力盛连接器有限公司、维仕科技有限公司形成。根据《企业会计准则》，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如发生减值，则应当确认商誉的减值损失，减值部分将冲减公司当期利润。

截至 2025 年 9 月 30 日，深圳亚力盛连接器有限公司、维仕科技有限公司经营情况正常，公司未曾计提商誉减值准备。若前述公司未来经营状况未能达到预期，将存在商誉减值风险，对公司业绩造成不利影响。

（六）新增折旧摊销的风险

本次募集资金投资项目建成后，固定资产、无形资产将大幅增加，公司每年将新增大额折旧摊销费。如果募投项目不能按照原定计划实现预期经济效益，新增折旧摊销费用也将对公司业绩产生一定的不利影响，如公司本次募投项目经营失败，未能给公司带来收益，则公司存在因折旧摊销费用大量增加而导致业绩下滑的风险。

（七）每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

本次发行将增加公司的股本总额及净资产规模，若公司净利润的增长速度在短期内低于股本及净资产的增长速度，则存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。

四、其他风险

（一）审批风险

本次发行方案尚需深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否完成上述程序以及完成时间均存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

（二）股价波动风险

本公司股票在深圳证券交易所上市交易，除经营情况和财务状况等公司基本因素外，股票价格还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，公司股价存在一定的市场波动风险。

（三）发行风险

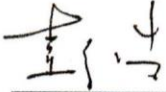
本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足的风险。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

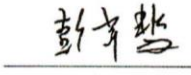
全体董事签名：

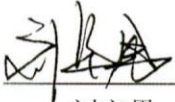

彭浩

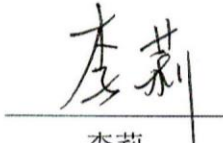

周进军


虞成城

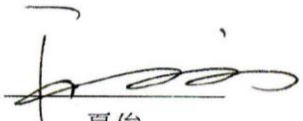

单莉莉


彭宇斐

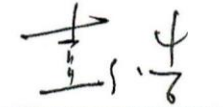

刘辛男


李莉


李天明


夏俊

全体高级管理人员签名：


彭浩


周进军


缪祥如


卢信


刘辛男

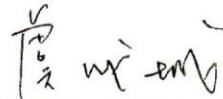
深圳市信维通信股份有限公司

2020年8月30日

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

<u> </u> 彭浩	<u> </u> 周进军	<u> </u>  虞成城
<u> </u> 单莉莉	<u> </u> 彭宇斐	<u> </u> 刘辛男
<u> </u> 李莉	<u> </u> 李天明	<u> </u> 夏俊

全体高级管理人员签名：

<u> </u> 彭浩	<u> </u> 周进军	<u> </u> 缪祥如
<u> </u> 卢信	<u> </u> 刘辛男	



一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

彭浩

周进军

虞成城

单莉莉

彭宇斐

刘辛男

李莉

李天明

夏俊

全体高级管理人员签名：

彭浩

周进军

缪祥如

卢信

刘辛男

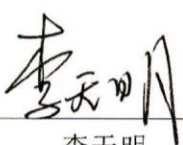


发行人审计委员会委员声明

本公司全体审计委员会委员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签名：


李莉


李天明

单莉莉

深圳市信维通信股份有限公司

2026年3月30日



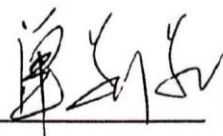
发行人审计委员会委员声明

本公司全体审计委员会委员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签名：

李莉

李天明



单莉莉


深圳市信维通信股份有限公司
2026年3月30日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：



彭浩

深圳市信维通信股份有限公司

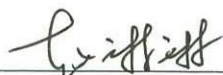
2026年3月30日



三、保荐人（主承销商）声明

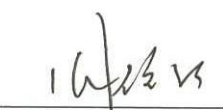
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

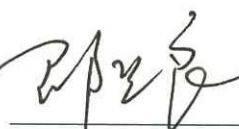

赵琳琳

保荐代表人签名：


金城


周依黎

法定代表人/董事长：

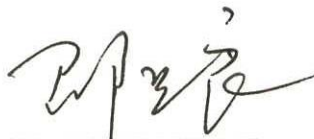

邵亚良



保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人/董事长：


邵亚良

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

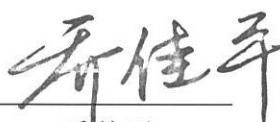
总经理：


周浩

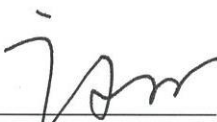
四、发行人律师声明

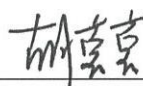
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


乔佳平

经办律师：


康晓阳


胡莹莹


肖雅婷


北京市康达律师事务所
2016年3月30日

五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”），确认募集说明书内容与本所出具的审计报告（天职业字[2023]31955 号、天职业字[2024]32831 号和天职业字[2025]19952 号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



会计师事务所负责人：

邱靖之



签字注册会计师：

张磊



范科磊



陈子涵



肖松涛

龙秀文（已离职）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



关于深圳市信维通信股份有限公司

签字注册会计师龙秀文离职的说明

本所作为深圳市信维通信股份有限公司的审计机构，出具了天职业字[2023]31955 号和天职业字[2024]32831 号的《审计报告》，签字注册会计师为陈子涵、肖松涛；出具了天职业字[2025]19952 号的《审计报告》，签字注册会计师为陈子涵、龙秀文。

龙秀文已于 2026 年 2 月从本所离职，故无法在深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书中的为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明中签字。本所为深圳市信维通信股份有限公司出具的天职业字[2023]31955 号、天职业字[2024]32831 号和天职业字[2025]19952 号《审计报告》内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此说明。



会计师事务所负责人：

邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年三月三十日



六、发行人董事会的有关声明

（一）除本次发行外，董事会未来十二个月内是否存在其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析。公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：

1、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用

本次发行募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事和审计委员会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、积极推进公司发展战略，不断提升自身盈利能力

本次募集资金将用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目实施后，公司将加快业务资源整合，争取充分发挥公司内部协同效应，并积极推进市场推广和业务开拓，争取实现公司整体效益的提升，进一步提高公司归属于母公司股东的净利润。

3、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

4、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、期间间隔和股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求和公司实际情况。同时，公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，制订了对股东回报的合理规划。

本次发行股票发行后，公司将依据相关法律法规及公司章程规定，实施积极的利润分配政策，并注重保持连续性和稳定性，同时努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，并保障公司股东利益。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

（三）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺如公司未来拟实施股权激励，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（四）公司的控股股东和实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人彭浩先生就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为本募集说明书《第七节 与本次发行相关的声明之“发行人董事会的有关声明”》之盖章页）

深圳市信维通信股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

